(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-249682

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51)Int.Cl. ⁵ G 0 3 F 7/03 7/00 7/02	503	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
7/26		7124-2H		
		7352-4M	H 0 1 L	21/ 30 3 0 1 R
			審査請求 未請求	求 請求項の数10(全 28 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-173830		(71)出願人	000252300
				和光純薬工業株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992) 6〕	₹8日		大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番2号
			(72)発明者	浦野 文良
(31)優先権主張番号	特願平3-173197			埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業
(32)優先日	平3 (1991) 6月18日	3		株式会社東京研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	藤江 啓利
(31)優先権主張番号				埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業
(32)優先日	平3(1991)9月26日	3		株式会社東京研究所内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	大野(桂二)
				埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業
				株式会社東京研究所内
				最終頁に続く

(54)【発明の名称】 新規なレジスト材料及びパターン形成方法

(例えばp-1-メトキシ-1-メチルエトキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン重合体、)で示される重合体と、露光により酸を発生する感光性化合物と、これらを溶解可能な溶剤を含んで成る事を特徴とするレジスト材料。

【効果】本発明のレジスト材料を300 nm以下の光源、例えば遠紫外光(Deep UV)、例えばKrFエキシマレー

ザ光 (248.4 nm) 等の露光用レジスト材料として用いた場合には、極めて高い解像性能を有し、且つ露光から加熱処理 (ポストベーク) 迄の時間経過に対して安定したパターン寸法の維持が可能な、実用的なクォーターミクロンオーダーの形状の良い微細なパターンが容易に得られる。従って本発明は、半導体産業等に於ける超微細パターンの形成にとって大きな価値を有するものである。

【特許請求の範囲】

*【化1】

【請求項1】一般式[1]

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ - C - C + 1 \\ \hline$$

[式中、R¹は水素原子又はメチル基を表し、R²及びR 10※す。)を表し、又、R⁵とR⁷は互いに結合して-CO-3は夫々独立して水素原子又は炭素数1~6の直鎖状、 分枝状又は環状のアルキル基を表し(但し、R²及びR³ が共に水素原子の場合は除く。)、又、R2とR3で炭素 数2~5のメチレン鎖を形成していても良く、R⁴は炭 素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、炭 素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のハロアルキル 基、又はアラルキル基を表し、R⁵は水素原子又はシア ノ基を表し、R⁶は水素原子又はメチル基を表し、R⁷は 水素原子、シアノ基又は一COOY(但し、Yは炭素数 1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基を表

[式中、R¹は水素原子又はメチル基を表し、R²及びR 3は夫々独立して水素原子又は炭素数1~6の直鎖状、 分枝状又は環状のアルキル基を表し(但し、R²及びR³ が共に水素原子の場合は除く。)、又、R2とR3とで炭 素数2~5のメチレン鎖を形成していても良く、R⁴は 炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、 炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のハロアルキル 基、又はアラルキル基を表し、kとlは夫々独立して自 然数を表す{但し、0.1 ≦ k / (k+1) ≦ 0.9であ レジスト材料。

【請求項3】一般式 [II] に於て、R¹が水素原子であ り、R²が水素原子又は炭素数1~6の直鎖状又は分枝 状のアルキル基であり、R3が炭素数1~6の直鎖状又 は分枝状のアルキル基であり、R⁴が炭素数1~10の直 鎖状又は分枝状のアルキル基である、請求項2に記載の レジスト材料。

【請求項4】一般式「II]に於て、R¹が水素原子であ り、R²が水素原子又はメチル基であり、R³がメチル基 又はエチル基であり、R⁴が炭素数1~4の直鎖状又は 分枝状のアルキル基である、請求項2に記載のレジスト 材料。

【請求項5】重合体の重量平均分子量が3000~20000で

O-CO-となっていても良く、kとlは夫々独立して 自然数を表し {但し、0.1 ≤ k / (k+1) ≤ 0.9であ る。〉、mは0又は自然数を表す(但し、mが自然数の 場合、0.05≦m/(k+l+m)≦0.50である。)。] で示される重合体と、露光により酸を発生する感光性化 合物と、これらを溶解可能な溶剤を含んで成る事を特徴 とするレジスト材料。

【請求項2】一般式[1]で示される重合体が下記一般 式[II]

【化2】

ある、請求項1~4の何れかに記載のレジスト材料。 【請求項6】露光により酸を発生する感光性化合物が下

【化3】

記一般式[III]

$$R^* - \frac{0}{5} - C - \frac{0}{5} - R^*$$
 [111]

[式中、R®及びR®は夫々独立して炭素数1~10の直鎖 状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数1~10のハロ アルキル基又は一般式 [IV]

[化4]

{式中、R1°及びR11は夫々独立して水素原子、炭素数 1~5の直鎖状又は分枝状のアルキル基、又は炭素数1 ~5のハロアルキル基(直鎖状、分枝状いずれにても 可。) を表し、nは0又は自然数を表す。} を表す。] で示される化合物である、請求項1~5の何れかに記載 のレジスト材料。

【請求項7】露光により酸を発生する感光性化合物が下

記一般[V] 【化5】

[式中、R¹²は炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基、トリフルオロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、R¹³及びR¹⁴は夫々独立して水素原子又は炭素数1~5の直鎖状又は分枝状のアルキル基を表し、R¹⁵は炭素数1~10の直鎖状、分枝 10状又は環状のアルキル基、フェニル基、ハロゲン置換フェニル基、アルキル置換フェニル基、アルコキン置換フェニル基又はアルキルチオ置換フェニル基を表す。]で示される化合物である、請求項1~5の何れかに記載のレジスト材料。

【請求項8】露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式[VI]

【化6】

[式中、 R^{16} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基、トリフルオロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、 R^{17} は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基又はアルコキシ基を表す。]で示される化合物である、請求項 $1\sim5$ の何れかに記載のレジスト材料。

【請求項9】露光により酸を発生する感光性化合物が下記一般式[VII]

【化7】

$$R^{18} - O - C H \xrightarrow{R^{19}} R^{20}$$
 [v II]

[式中、R¹⁸はトリクロルアセチル基、p-トルエンスルホニル基、p-トリフルオロメチルベンゼンスルホニル基、メタンスルホニル基又はトリフルオロメタンスルホニル基を表し、R¹⁹及びR²⁰は夫々独立して水素原子、ハロゲン原子又はニトロ基を表す。]で示される化合物である、請求項1~5の何れかに記載のレジスト材 40料。

【請求項10】(i)請求項1に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(ii)加熱処理の後、マスクを介して300 nm以下の光で露光する工程と、(iii)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程と、から成るパターン形成方法。

[0001]

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は半導体素子等の製造に於いて用いられるレジスト材料に関する。詳しくは露光エ 50

ネルギー源として300 nm以下の遠紫外光、例えば248.4 nmのKrFエキシマレーザ光等を用いてポジ型のパターンを形成する際のレジスト材料に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体デバイスの高密度集積化に伴い、微細加工、中でもフォトリソグラフィに用いられる露光装置の光源は益々、短波長化し、今ではKrFエキシマレーザ光(248.4nm)が検討されるまでになってきている。しかしながらこの波長に適したレジスト材料は未だ適当なものが見出されていない。

【0003】例えば、KrFエキシマレーザ光や遠紫外 光を光源とするレジスト材料として248.4nm付近の光に 対する透過性が高い樹脂と分子内にジアゾジケト基を有 する感光性化合物より成る溶解阻害型のレジスト材料が 開発されている(例えば、特開平1-80944号公報:特開 平1-154048号公報;特開平1-155338号公報;特開平1-15 5339号公報;特開平1-188852号公報;Y. Taniら、SPIE's 1989 Sympo., 1086-03等)。しかし、これ等の溶解阻害 型レジスト材料は共通して感度が低く、高感度レジスト 20 材料が要求される遠紫外光、KrFエキシマレーザ光用 途には使用出来ない。又、近年、露光エネルギー量を低 減させる方法(高感度化)として露光により発生した酸 を媒体とする化学増幅型のレジスト材料が提案され「H. Ito ら、Polym. Eng. Sci., 23巻, 1012頁 (1983年)]、 これに関して種々の報告がなされている(例えば、H. It o ら、米国特許 第4491628 号(1985); J. V. Crivello、 米国特許第4603101 号(1986); W.R.Brunsvolt ら、SPI E's 1989 Sympo., 1086-40; T. Neenan 5, SPIE's 1989 S ympo.,1086-01;特開昭62-115440号公報等)。しかし 30 ながら、これ等既存の化学増幅型レジスト材料は、使用 される樹脂が、例えば、ポリ(4-tert-ブトキシカルボ ニルオキシスチレン)、ポリ(4-tert-ブトキシカルボ ニルオキシ-α-メチルスチレン)、ポリ(4-tert-ブト キシスチレン)、ポリ (4-tert-ブトキシ-α-メチルス チレン)等のフェノールエーテル系樹脂の場合にはいず れも耐熱性に乏しく、又、基板との密着性が不良の為現 像時に膜はがれし易く、良好なパターン形状が得られな いという欠点を有しており、又、カルボン酸エステル系 の樹脂、例えば、ポリ(tert-ブチル-4-ビニルベンゾエ イト) 等の場合には芳香環に起因して248.4 nm付近の光 透過性が不十分であったり、ポリ(tert-ブチルメタク リレート) 等の場合には樹脂の耐熱性及びドライエッチ 耐性が乏しい等の問題点を夫々有している。

【0004】この他、シリル含有ポリマーを用いたレジスト材料も開示されている(例えば、特公平3-44290号公報等)が、例えばp-トリメチルシリルオキシスチレン重合体やp-tert-ブチルジメチルシリルオキシスチレン重合体を使用した場合、感度が低い、ケイ素含有の為アッシングで完全には除去できない等の問題があり実用化は困難である。

レジスト材料としてp-tert-ブトキシカルボニルオキシ スチレンとp-ヒドロキシスチレンとの共重合体を用いた

レジスト材料(特開平2-209977号公報)、p-テトラヒド

ロピラニルオキシスチレンとp-ヒドロキシスチレンとの

報;特開平2-161436号公報;特開平2-25850号公報)、p

-tert-ブトキシスチレンとp-ヒドロキシスチレンとの共

重合体を用いたレジスト材料 (特開平2-62544号公報)

等が報告されている。しかしながら、これ等p-tert-ブ

トキシカルボニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレ

ン、p-テトラヒドロピラニルオキシスチレン-p-ヒド

ロキシスチレン、p-tert-ブトキシスチレン-p-ヒドロ

キシスチレン等の共重合体をレジスト材料の樹脂成分と

して用いた場合、高感度を保ち、且つtert-ブトキシカ

ルボニル基、テトラヒドロピラニル基、tert-ブチル基

等の保護基を脱離させてアルカリ可溶性にする為には強

い酸を存在させる必要がある。それ故、上記共重合体を

樹脂成分としたレジスト材料に於ては、感光剤(感光性

リフェニルスルホニウム塩、ジフェニルヨードニウム

塩、トリス (トリクロロメチル) -S-トリアジン/トリ

エタノールアミン等が使用されているが、このように強

い酸の存在下でパターン形成を行った場合、露光から加

熱処理までの時間経過に伴って、パターン寸法が著しく

変化したり、全くパターン形成出来なくなったりするの

も、露光から加熱処理までに時間を要する実際の操作に

【0006】又、上記した感光剤類は総じて不安定な

為、これらを含んで成るレジスト材料の貯蔵安定性も不

良であり、何れにしても、そのままでは実使用は不可能

で、極めて短い時間ではパターン形成が可能であって

於いては良好なパターン形成は出来ない。

という問題を抱えている。

化合物) として、露光により極めて強い酸を発生するト 20

共重合体を用いたレジスト材料 (特開平2-19847号公

*【0007】尚、上記各重合体又は共重合体に於て、水酸基の保護基として使用されている、tert-ブトキシカルボニル基、tert-ブチル基、トリメチルシリル基、テトラヒドロピラニル基等は共通して強い酸の存在下でも完全には脱離されない為、これ等の保護基で水酸基を保護されたモノマー成分を有する重合体又は共重合体を樹

脂成分として用いた既存のレジスト材料は何れも露光部と未露光部間のアルカリ現像液に対する溶解速度差が小さく、その結果、解像性能が不十分である等の問題を共10 通して抱えている。

[0008]

【発明が解決しようとする問題点】このように化学増幅型レジスト材料は従来のレジスト材料と比べて高感度化されたにもかかわらず、樹脂の耐熱性が乏しい、基板との密着性が不良である、248.4 nm付近の光透過性が不十分である、解像性能が不十分である、或いは経時的にパターン寸法が変化する等の問題点を有し、実用化は難しい。従って、これ等の問題点を全て改善した実用的な高感度レジスト材料が渇望されている現状にある。

[0009]

【発明の目的】本発明は上記した如き状況に鑑みなされたもので、遠紫外光、KrFエキシマレーザ光等に対し高い透過性を有し、これ等光源による露光や電子線、X線照射に対して高い感度を有し、耐熱性及び基板との密着性が極めて優れ、高解像性能を有し、且つパターン寸法が経時変化せずに精度の高いパターンが得られる実用的なポジ型レジスト材料を提供する事を目的とする。

[0010]

【発明の構成】上記目的を達成する為、本発明は下記の 30 構成から成る。

『(1) 下記一般式[I]

[0011]

11K81

【0012】 [式中、R¹は水素原子又はメチル基を表し、R²及びR³は夫々独立して水素原子又は炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基を表し(但し、R²及びR³が共に水素原子の場合は除く。)、又、R²とR³で炭素数2~5のメチレン鎖を形成していても良く、R⁴は炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、皮はアラルキル基を表し、R⁵は水素原子又はシアノ基を表し、R⁵は水素原子又はメチル基を表し、R⁵は水素原子、シアノ基又は一COOY(但

し、Yは炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基を表す。)を表し、又、 R^5 と R^7 は互いに結合して一CO-O-CO-となっていても良く、kと1は夫々独立して自然数を表し{但し、 $0.1 \le k$ /(k+1) ≤ 0.9 である。}、mは0 又は自然数を表す(但し、mが自然数の場合、 $0.05 \le m$ /(k+1+m) ≤ 0.50 である。)。]で示される重合体と、露光により酸を発生する感光性化合物と、これらを溶解可能な溶剤を含んで成る事を特徴とするレジスト材料。

(2) (i) (1) に記載のレジスト材料を基板上に塗

6

布する工程と、(ii) 加熱処理の後、マスクを介して30 nm以下の光で露光する工程と、(iii) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程と、から成るパターン形成方法。』

【0015】(式中、R1、R2、R3、R4、R5、R R⁷、k、 l 及びmは前記の通り。) で示される重 合体を樹脂成分とする化学増幅型レジスト材料が該目的 を達成し得る事を見出し、本発明を完成するに至った。 一般式[I]に於いて、R2及びR3で示される炭素数1 ~6のアルキル基、R⁴で示される炭素数1~6のハロ アルキル基のアルキル基、R5で示されるCOOR8のR *で示される炭素数1~6のアルキル基としては、メチ ル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、ヘ 20 キシル基が挙げられる(直鎖状、分枝状又は環状の何れ にても可)。R⁴で示される炭素数1~10のアルキル基 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、アミル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、 ノニル基、デシル基が挙げられる(直鎖状、分枝状又は 環状の何れにても可)。R⁴で示される炭素数1~6の ハロアルキル基のハロゲンとしては、塩素、臭素、フッ 素、ヨウ素が挙げられる。又、R⁴で示されるアラルキ ル基としては、例えばベンジル基、フェネチル基、フェ ニルプロピル基、メチルベンジル基、メチルフェネチル 30 基、エチルベンジル基等が挙げられる。

【0016】本発明に係る一般式[I]で示される重合体は、酸で脱離し得る一般式[VIII]

[0017]

【化10】

$$-0 - \frac{R^{2}}{C} - 0 R^{4} \qquad [viii]$$

【0018】(式中、R²、R³及びR⁴は前記と同じ。)で示される官能基、即ちアルコキシアルキル基、ハロアルコキシアルキル基又はアラルキルオキシアルキル基を有するモノマー単位、即ち、一般式[IX]

[0019]

【化11】

*【0013】即ち、本発明者らは上記目的を達成すべく 鋭意研究を重ねた結果、一般式[[]]

[0014]

【化9】

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
-C - C H_{2} - \\
\hline
0 - C - O R^{4}
\end{array}$$
[1x]

【0020】(式中、R¹、R²、R³及びR⁴は前記と同じ。)で示されるモノマー単位を含んでなる点に最大の特徴を有する。特に一般式 [VIII] で示される官能基は既存のtert-ブトキシカルボニル基、tert-ブチル基や類似したテトラヒドロピラニル基等の官能基に比較して酸により極めて脱離し易い為、解像性能の向上に及びパターン寸法維持の点で大幅に有利である。

【0021】一般式「IX」で示されるモノマー単位 は、具体的には一般式 [VIII] で示される官能基を有 するp-又はm-ヒドロキシスチレン誘導体、p-又はm-ヒド ロキシ-α-メチルスチレン誘導体等のモノマーに起因す るものであるが、それ等のモノマーの具体例としては、 例えばp-又はm-1-メトキシ-1-メチルエトキシスチレ ン、p-又はm-1-ベンジルオキシ-1-メチルエトキシスチ レン、p-又はm-1-エトキシエトキシスチレン、p-又はm-1-メトキシエトキシスチレン、p-又はm-1-n-ブトキシエ トキシスチレン、p-又はm-1-イソブトキシエトキシスチ レン、p-又はm-1-(1,1-ジメチルエトキシ)-1-メチル エトキシスチレン、p-又はm-1-(1,1-ジメチルエトキ シ) エトキシスチレン、p-又はm-1-(2-クロルエトキ シ) エトキシスチレン、p-又はm-1-シクロヘキシルオキ シエトキシスチレン、p-又はm-1-シクロペンチルオキシ 40 エトキシスチレン、p-又はm-1-(2-エチルヘキシルオキ シ) エトキシスチレン、p-又はm-1-エトキシ-1-メチル エトキシスチレン、p-又はm-1-n-プロポキシエトキシス チレン、p-又はm-1-メチル-1-n-プロポキシエトキシス チレン、p-又はm-1-エトキシプロポキシスチレン、p-又 はm-1-メトキシブトキシスチレン、p-又はm-1-メトキシ シクロヘキシルオキシスチレン及びこれ等p-又はm-ヒド ロキシスチレン誘導体と同様の保護基を有するp-又はm-ヒドロキシ-α-メチルスチレン誘導体が挙げられる。 又、これ等のモノマー単位の中、特に一般式 [IX] に

50 於いてR²及びR³が何れもアルキル基である、p-又はm-

1-メトキシ-1-メチルエトキシスチレン、p-又はm-1-ベ ンジルオキシ-1-メチルエトキシスチレン、p-又はm-1-(1,1-ジメチルエトキシ) -1-メチルエトキシスチレ ン、p-又はm-1-エトキシ-1-メチルエトキシスチレン、p -又はm-l-メチル-l-n-プロポキシエトキシスチレン等は 酸の作用により保護基が極めて脱離し易く、本発明の目 的の一つである解像性能の向上により好ましい。

【0022】本発明に係る重合体は上記一般式 [IX] で示されるモノマー単位以外に、一般式 [X]

[0023]

【化12】

【0024】(式中、R¹は前記と同じ。)で示される モノマー単位と、要すれば一般式 [XI]

[0025]

【化13】

20

【0030】 [式中、R1は水素原子又はメチル基を表 し、R²及びR³は失々独立して水素原子又は炭素数1~ 6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基を表し(但 し、R²及びR³が共に水素原子の場合は除く。)、又、 R²とR³とで炭素数2~5のメチレン鎖を形成していて も良く、R⁴は炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状 のアルキル基、炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状 のハロアルキル基、又はアラルキル基を表し、kとlは 夫々独立して自然数を表す {但し、0.1 ≦ k / (k+ 1) ≤ 0.9である。 }。]で示される重合体となる。

【0031】一般式[I]又は[II]で示される本発明 に係る重合体に於いて、上記一般式 [IX] で示される モノマー単位と、一般式 [X] で示されるモノマー単位 40 の構成比は通常1:9乃至9:1であり、何れの場合も 本発明のレジスト材料として使用可能であるが重合体の 耐熱性及び基板との密着性を極めて良好にする2:8乃 至7:3がより好ましい。

【0032】本発明に係る重合体の具体例としては例え ばp-1-メトキシ-1-メチルエトキシスチレンーp-ヒドロ キシスチレン重合体、p-1-ベンジルオキシ-1-メチルエ トキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-エ トキシエトキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン重合 体、p-1-メトキシエトキシスチレン-p-ヒドロキシスチ 50

10

【0026】(式中、R5、R6及びR7は前記と同 じ。) で示されるモノマー単位とを含んで成る共重合体 である。一般式〔X〕で示されるモノマー単位はフェノ ール性水酸基を有するモノマーに起因するものである が、それ等のモノマーの具体例としてはp-又はm-ビニル 10 フェノール、p-又はm-ヒドロキシ-α-メチルスチレンが 挙げられる。

【0027】本発明に係る重合体の第三の成分である一 般式 [XI] で示されるモノマー単位としては例えばア クリロニトリル、フマロニトリル、メタクリル酸メチ ル、メタクリル酸 tert-ブチル、無水マレイン酸等のモ ノマー単位が挙げられる。

【0028】一般式[1]で示される本発明に係る重合 体に於て、m=0の場合は即ち、第三の成分を含まない 場合は必然的に下記一般式 [II]

【化14】

[0029]

レン重合体、p-1-n-ブトキシエトキシスチレン-p-ヒド ロキシスチレン重合体、p-1-イソブトキシエトキシスチ 30 レンーp-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-(1,1-ジメチ ルエトキシ) -1-メチルエトキシスチレン-p-ヒドロキ シスチレン重合体、m-1-(2-クロルエトキシ) エトキシ スチレンーm-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-シクロへ キシルオキシエトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン 重合体、m-1-(2-エチルヘキシルオキシ)エトキシスチ レンーm-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-メトキシ-1-メチルエトキシ-α-メチルスチレン-p-ヒドロキシ-α-メチルスチレン重合体、p-1-エトキシエトキシスチレン ーp-ヒドロキシスチレンーアクリロニトリル重合体、p-1-エトキシエトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレンー フマロニトリル重合体、p-1-n-ブトキシエトキシスチレ ンーp-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸メチル電合 体、p-1-シクロヘキシル-1-エトキシエトキシスチレン ーp-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸 tert-ブチル重 合体、p-1-メトキシシクロヘキシルオキシスチレン--p-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-エトキシ-1-メチルエ トキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン重合体、p-1-シ クロペンチルオキシエトキシスチレンーp-ヒドロキシス チレン重合体、p-1-(2-クロルエトキシ)エトキシスチ レンーp-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸 tert-ブチ

12

ル重合体、m-l-シクロヘキシルオキシエトキシスチレンーm-ヒドロキシスチレンー無水マレイン酸重合体等が挙げられるが、勿論これ等に限定されるものではない。

【0033】本発明に係る重合体は、例えば下記a)~d)に示す4種の方法により容易に得る事が出来る。a) 方法-1

上記一般式 [VIII] で示される官能基を有する下記一般式 [XII]

[0034]

【化15】

$$C = CH^{2}$$

$$C = CH^{2}$$

$$(x 11)$$

【0035】(式中、R¹、R²、R³及びR⁴は前記と同 じ。) で示されるモノマー単独、又はこれと第3のモノ マーとを、重合体製造法の常法に従い例えばベンゼン、 トルエン、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等の有 20 機溶剤中、ラジカル重合開始剤 [例えば、2.2'-アゾビ スイソブチロニトリル、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチル ワレロニトリル)、2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオ ン酸メチル)等のアン系重合開始剤や過酸化ベンゾイ ル、過酸化ラウロイル等の過酸化物系重合開始剤等]の 存在下、窒素又はアルゴン気流中、50~ 110℃で 1~10 時間重合反応させる。反応後は高分子取得法の常法に従 って後処理を行って、上記一般式[IX]で示されるモ ノマー単位から成るホモ重合体または上記一般式 [I X] で示されるモノマー単位を含む共重合体を単離す る。次いでこのホモ重合体または共重合体をテトラヒド ロフラン、アセトン、1,4-ジオキサン等の有機溶剤中、 適当な酸[例えば、硫酸、リン酸、塩酸、臭化水素酸等 のルイス酸、p-トルエンスルホン酸、マロン酸、シュウ 酸等の有機酸が好ましい。] と30~ 100℃で 1~10時間 反応させて上記一般式 [VIII] で示される官能基を任 意の割合で脱離させる。反応後は高分子取得法の常法に 従って後処理を行い、目的とする重合体を単離する。

【0036】b) 方法-2

上記一般式 [XII] で示されるモノマーとp-又はm-ヒド 40 ロキシスチレン、p-又はm-ヒドロキシ-α-メチルスチレンと、要すれば第3のモノマーとを、方法-1と同様の操作法により共重合させた後、高分子取得法の常法に従って後処理を行い、目的とする重合体を単離する。

【0037】c) 方法-3

市販のp-tert-ブトキシスチレン単独、又はこれと第3のモノマーとを、方法-1と同様の操作法により重合反応させて得たポリ(p-tert-ブトキシスチレン)又はp-t ert-ブトキシスチレン単位を含む共重合体をテトラヒドロフラン、アセトン、1.4-ジオキサン等の有機溶剤中、

適当な酸 [例えば、硫酸、リン酸、塩酸、臭化水素酸等のルイス酸、p-トルエンスルホン酸、マロン酸、シュウ酸等の有機酸が好ましい。] と30~110 ℃で1 ~20時間反応させて官能基であるtert-ブチル基を完全に脱離させて得たポリ (p-ヒドロキシスチレン) 又は一般式

[X]で示されるモノマー単位を含む共重合体と任意の 量の下記一般式[XIII]

【0038】 【化16】

 R^{2} $H_{2} C = C - OR^{4} \qquad [x | I | I]$

【0039】(式中、R²及びR⁴は前記と同じ。)で示されるビニルエーテル化合物又はイソプロペニルエーテル化合物とを、テトラヒドロフラン、アセトン、1,4-ジオキサン、塩化メチレン、ジメトキシエタン等の有機溶剤中、適当な酸 [例えば、硫酸、塩酸、p-トルエンスルホン酸、クロルスルホン酸・ピリジン塩、硫酸・ピリジン塩、p-トルエンスルホン酸・ピリジン塩等]の存在下、10~100℃で1~20時間反応させ、上記一般式 [VIII]で示される官能基を任意の割合で化学的に導入させ、次いで高分子取得法の常法に従って後処理を行い、目的とする重合体を単離する。

【0040】d) 方法-4

市販のポリ (p-ヒドロキシスチレン) と任意の量の上記 一般式 [XIII] で示されるビニルエーテル化合物又は イソプロペニルエーテル化合物とを用いて方法-3と同様な操作法で反応させた後、高分子取得法の常法に従って後処理を行い、目的とする重合体を単離する。

【0041】本発明に係る重合体の製造法は上記方法一1~方法-4の何れにても良いが、248.4 nm付近の光透過性が良好な重合体が得られる、方法-1及び方法-3が特に好ましい。方法-2又は方法-4では、重合時にp-又はm-ヒドロキシスチレンを用いる事に起因して酸化等が生じ、その結果得られた重合体はこの波長領域での光透過性が不良となり解像性能に悪影響する為、方法-1及び方法-3と比べて有利な方法とは言えない。

【0042】本発明に係る重合体の平均分子量としてはレジスト材料として利用可能なものであれば特に限定することなく挙げられるが、好ましい範囲としては、ポリスチレンを標準とするGPC測定法により求めた重量平均分子量が通常1000~40000程度、より好ましくは3000~25000程度である。

【0043】本発明で用いられる露光により酸を発生する感光性化合物(以下、『酸発生剤』と略記する。)としては、文字通り露光により酸を発生する感光性化合物でレジストパターン形成に悪影響を及ぼさないものであれば何れにても良いが、特に248.4nm付近の光透過性が良好でレジスト材料の高透明性を維持出来る酸発生剤、又は露光により248.4nm付近の光透過性が高められレジ

スト材料の高透明性を維持出来る酸発生剤が好ましい。 本発明に於いて特に好ましい酸発生剤としては、例えば 下記一般式 [III] 、一般式 [V] 、一般式 [VI] 又は 一般式[VII]で表される化合物が挙げられる。

[0044]

【化17】

$$R^* - \frac{0}{5} - C - \frac{0}{5} - R^*$$
 [111]

【0045】 [式中、R®及びR®は夫々独立して炭素数 1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、炭素数 1~10のハロアルキル基又は一般式 [IV]

[0046]

【化18】

原子、炭素数1~5の直鎖状又は分枝状のアルキル基、 又は炭素数1~5のハロアルキル基(直鎖状、分枝状何 れにても可。) を表し、nは0又は自然数を表す。) を 表す。]

[0048]

【化19】

$$R^{12} = \begin{cases} 0 & R^{12} \\ 0 & C \\ 0 & R^{14} \end{cases} = R^{15}$$
 [v]

【0049】 [式中、R¹²は炭素数1~10の直鎖状、分 30 枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基、トリフルオ ロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、R¹³及び R¹⁴は夫々独立して水素原子又は炭素数1~5の直鎖状 又は分枝状のアルキル基を表し、R15は炭素数1~10の 直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、フェニル基、ハ ロゲン置換フェニル基、アルキル置換フェニル基、アル コキシ置換フェニル基又はアルキルチオ置換フェニル基 を表す。]

[0050]

【化20】

$$R^{10} - \stackrel{\circ}{S} - C - C - R^{17}$$

$$\stackrel{\circ}{O} \stackrel{\circ}{N} \stackrel{\circ}{O} \stackrel{\circ}{O} \qquad [v \ 1]$$

【0051】 [式中、R16は炭素数1~10の直鎖状、分 枝状又は環状のアルキル基、アラルキル基、トリフルオ ロメチル基、フェニル基又はトリル基を表し、R¹⁷は炭 素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基、ア ラルキル基又はアルコキシ基を表す。〕

[0052]

【化21】

【0053】 [式中、R¹⁸はトリクロルアセチル基、p-トルエンスルホニル基、p-トリフルオロメチルベンゼン スルホニル基、メタンスルホニル基又はトリフルオロメ タンスルホニル基を表し、R¹º及びR²ºは夫々独立して 水素原子、ハロゲン原子又はニトロ基を表す。]

【0054】本発明に於いて用いられる好ましい酸発生 剤の具体例としては、例えばビス (p-トルエンスルホニ ル) ジアゾメタン、メチルスルホニル p-トルエンスル ホニルジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1-(1.1-ジメチルエチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (1, 1-ジメチルエチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (1-メチルエチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シ クロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、1-p-トルエン スルホニル-1-シクロヘキシルカルボニルジアソメタ ン、2-メチル-2- (p-トルエンスルホニル) プロピオフ 【0047】 (式中、R¹⁰及びR¹¹は夫々独立して水素 20 ェノン、2-メタンスルホニル-2-メチル- (4-メチルチ オ) プロピオフェノン、2,4-ジメチルー2- (p-トルエン スルホニル) ペンタン-3-オン、1-ジアゾ-1-メチルスル ホニル-4-フェニル-2-ブタノン、2-(シクロヘキシルカ ルボニル)-2- (p-トルエンスルホニル)プロパン、1-シクロヘキシルスルホニル-1-シクロヘキシルカルボニ ルジアゾメタン、1-ジアゾ-1-シクロヘキシルスルホニ ル-3, 3-ジメチル-2-ブタノン、1-ジアゾ-1-(1, 1-ジメ チルエチルスルホニル) -3,3-ジメチル-2-ブタノン、1-アセチル-1- (1-メチルエチルスルホニル) ジアソメタ ン、1-ジアゾ-1-(p-トルエンスルホニル)-3、3-ジメチ ルー2-ブタノン、1-ジアゾー1-ベンゼンスルホニルー3,3-ジメチル-2-ブタノン、1-ジアゾ-1- (p-トルエンスルホ ニル) -3-メチル-2-ブタノン、2-ジアゾ-2- (p-トルエ ンスルホニル) 酢酸 シクロヘキシル、2-ジアゾ-2-ベ ンゼンスルホニル酢酸 tert-ブチル、2-ジアゾ-2-メタ ンスルホニル酢酸イソプロピル、2-ジアゾ-2-ベンゼン スルホニル酢酸 シクロヘキシル、2-ジアゾ-2- (p-トル エンスルホニル) 酢酸 tert-ブチル、p-トルエンスルホ ン酸 2-ニトロベンジル、p-トルエンスルホン酸 2,6-40 ジニトロベンジル、p-トリフルオロメチルベンゼンスル ホン酸 2,4-ジニトロベンジル等が挙げられるがこれ等 に限定されるものではないことは言うまでもない。

【0055】又、上記以外の酸発生剤として従来から種 々のトリフェニルスルホニウム塩及びジフェニルヨード ニウム塩等が知られているがこれ等を化学増幅型レジス ト材料の酸発生剤として使用した場合、露光により発生 した酸(ルイス酸)が強酸であり、且つ揮発性に富んで いる事に起因して、露光後にレジスト膜表層から揮発し たり、アミン等の雰囲気の影響を極めて受け易く、その 50 結果、露光から現像迄の時間が経過するに従い、パター

る。

ン形成で膜張り(T-shape)が発生したり、パターン形成寸法が大きく変化したり、又は全くパターン形成が出来ない等の問題があるので好ましくない。本発明に係る重合体の場合はこのような強酸を発生する酸発生剤を使用する必要がないことが大きな特徴の一つとなってい

【0056】本発明で用いられる溶剤としては、重合体 と酸発生剤の両者を溶解可能なものであれば何れにても 良いが、通常は230~300 mm付近に吸収を有しないもの がより好ましく用いられる。具体的にはメチルセロソル 10 プアセテート、エチルセロソルブアセテート、プロピレ ングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸メチ ル、乳酸エチル、酢酸 2-エトキシエチル、ピルビン酸 メチル、ピルビン酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メ チル、3-メトキシプロピオン酸エチル、N-メチル-2-ピ ロリドン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、1, 4-ジオキサン、エチレングリコールモノイソプロピルエ ーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレング リコールジメチルエーテル等が挙げられるが、勿論これ 20 等に限定されるものではない。又、本発明のレジスト材 料は、通常上記の三成分(重合体、酸発生剤、溶剤)を 主たる構成成分とするが、必要に応じてフルオレノン誘 導体、アントラセン誘導体又はピレン誘導体等の染料や 界面活性剤又は分子内にジアゾジケト基(一CO一C $(=N_2)$ -CO-) 又はジアゾケト基 (-CO-C)2)一)を含有する光漂白剤等を添加しても良い。

【0057】本発明に係るレジスト材料を用いてパター ン形成を行うには、例えば以下の如く行えば良い。本発 明に係る化合物を含むレジスト材料をシリコンウェハー 30 等の基板の上に厚みが0.5~2 μm程度となるように塗 布 (3層の上層として用いる場合には0.1~0.5μm程 度) し、これをオーブン中で70~130 ℃、10~30分間、 若しくはホットプレート上で70~130℃、1~2分間プ レベークする。次いで目的のパターンを形成するための マスクを上記のレジスト膜上にかざし、300 nm以下の遠 紫外光を露光量(exposure dose) 1 ~100 mJ/c m²程 度となるように照射した後、ホットプレート上で70~15 0 ℃、1 ~2 分間ベークする。更に、0.1 ~5 %テトラ メチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液等 40 の現像液を用い、0.5 ~3 分程度、浸漬(dip) 法、パド ル(puddle)法、スプレー法等の常法により現像すれば、 基板上に目的のパターンが形成される。

【0058】本発明に係る重合体と酸発生剤との、ポジ型レジスト材料に於ける混合比としては、重合体1重量に対して酸発生剤は0.01~0.3 重量、好ましくは0.01~

16

0.1重量付近が挙げられる。又、本発明のレジスト材料中の溶剤の量としては、本発明に係る重合体と酸発生剤とを溶解した結果得られるポジ型レジスト材料を基板上に塗布する際に支障をきたさない量であれば特に限定されることなく挙げられるが、通常、重合体1重量に対して1~20重量、好ましくは1.5~6重量付近が挙げられる。

【0059】又、上記した如き各種パターン形成法に於いて用いられる現像液としては、レジスト材料に使用する重合体のアルカリ現像液に対する溶解性に応じて、未露光部は殆ど溶解させず、露光部は溶解させるような適当な濃度のアルカリ溶液を選択すれば良く、通常0.01~20%の範囲から選択される。又、使用されるアルカリ溶液としては、例えばTMAH、コリン、トリエタノールアミン等の有機アミン類、例えばNaOH、KOH 等の無機アルカリ類を含む溶液が挙げられる。

【0060】本発明に係る重合体は、上記した如く一般式 [VIII]で示される官能基を有する一般式 [IX]で示されるモノマー単位を含んで成ることに起因して、従来の同種目的で使用される重合体に比して、酸の存在下、より容易に官能基を脱離してアルカリ可溶性になり易い性質を有しており、そのため露光から加熱処理(ベーク)までの時間経過に対して安定したパターン寸法の維持が可能である。又、本発明に係る重合体は、一般式 [X]で示されるヒドロキシスチレン単位を含んで成ることに起因して、耐熱性を有し、ドライエッチ耐性を有し、且つ基板との密着性にも優れている。尚、一般式 [I] 又は一般式 [II] に於いてR²及びR³が共に水素原子(例えば、p-アルコキシメトキシスチレン)の場合には、当該レジスト材料がネガ型に作用するので本発明

【0061】一般式 [III]、 [V]、 [VI] 又は [V II] で示される酸発生剤を含んで成る本発明のレジスト材料はK.r Fエキシマレーザ光はもとより、電子線やX線照射でも酸が発生し、化学増幅作用することが確認されている。従って、本発明のレジスト材料は化学増幅法を利用して低露光量の遠紫外光、Kr Fエキシマレーザ光(248.4 nm)や電子線或いはX線照射法によりパターン形成可能なレジスト材料である。

0 [0062]

には適用不可である。

【作 用】本発明の作用について具体例で説明すると、 先ず、KrFエキシマレーザ光、遠紫外光等で露光され た部位は例えば下記式1、式2、式3又は式4で示され る光反応に従って酸が発生する。

[0063]

【式1】

17

[式1]

【0064】 【式2】

H₂ C-
$$\bigcirc$$
- \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc - \bigcirc - \bigcirc -SO, H + \bigcirc -SO, H

【0065】 [式3]

【0066】 【式**4**】

H, C-
$$\bigcirc$$
 O₂ N
 \bigcirc O₂ N
 \bigcirc O₃ N
 \bigcirc O₄ N
 \bigcirc O₂ N
 \bigcirc O₃ N
 \bigcirc O₄ N
 \bigcirc O₇ N
 \bigcirc O₈ N

【0067】露光工程に続いて加熱処理すると下記式5 の反応式に従って本発明に係る重合体の特定の官能基

☆となって、現像の際、現像液に溶出してくる。

[0068]

【式5】

(式5では、1-エトキシエトキシ基として例示。)が酸 30 により化学変化を受けて水酸基となり、アルカリ可溶性☆

[式5]

【0069】他方、未露光部は酸が発生しない為、加熱
処理しても化学変化は起こらず、かえって基板との密着
性強化の目的で用いた重合体の親水性基部位を酸発生剤 40
がアルカリ現像液の浸潤から保護するような作用が発現
する。このように本発明のレジスト材料を用いてパターン形成を行った場合には露光部と未露光部との間でアルカリ現像液に対して大きな溶解度差を生じ、しかも未露光部の重合体が基板に対して強い密着性を有している為、現像時に膜剥がれを引き起こさず、その結果、良好なコントラストを有したポジ型のパターンが形成される。又、前記式5で示されるように露光で発生した酸は
触媒的に作用する為、露光は必要な酸を発生させるだけで良く、露光エネルギー量の低減が可能となる。 50

【0070】以下に実施例、製造例、参考例及び比較例 を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれ 等により何等制約を受けるものではない。

【0071】製造例1. ポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] の合成 [方法-1]

(1)p-ブロムー (1-エトキシエトキシ) ベンゼンの合成 p-ブロムフェノール50g (0.29モル)、エチルビニルエーテル41.7g (0.58モル)及びp-トルエンスルホン酸・ピリジン塩1.5 gを塩化メチレン300mlに溶解し、室温で6時間撹拌反応させた。次いで5%炭酸水素ナトリウム水溶液400mlを注入し、撹拌後、静置分液して有機層50を分取、これを水洗(300ml×3)、無水硫酸マグネシ

ウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶剤留去し、残渣82gを減圧蒸留してbp. 112~114℃/6 mmHg留分のp-ブロム-(1-エトキシエトキシ)ベンゼン71.1gを微黄色油状物として得た。

¹ H N M R δ ppm (CDCl₃) : 1.20 (3H, t, J=7Hz, -CH₂CH₃), 1.49 (3H, d, J=5.1Hz, -OCHCH₃), 3.47~3.83 (2H, m, -CH₂CH₃), 5.31~5.37 (1H, q, J=5.5Hz, -OCHCH₃), 6.95 (2H, d, J=8.8Hz, 芳香環2-H, 6-H), 7.32 (2H, d, J=8.8Hz, 芳香環3-H, 5-H)。
I R (Neat) ν c m⁻¹: 2970, 2930, 2890, 1595, 1490。

【 O O 7 2】(2)p-(1-エトキシエトキシ) スチレンの 合成

窒素気流中、乾燥テトラヒドロフラン30mlに金属マグネ シウム (削り状) 3.7g (0.15原子) を懸濁させ、これ に上記(1)で得たp-ブロム-(1-エトキシエトキシ)べ ンゼン35g (0.14モル) の乾燥テトラヒドロフラン (15 Oml) 溶液を撹拌還流下、滴下し、更に1 時間撹拌還流 させた。次いで反応液を10℃に冷却した後、ジクロル 【1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン】ニッケル 0.8 gを添加し、窒素気流下で臭化ビニル15.3g (0.14 20 モル)の乾燥テトラヒドロフラン (50ml) 溶液を20~30 ℃で滴下し、更に室温で1 時間撹拌した。反応液に塩化 アンモニウム水溶液200mlを注入後、塩化メチレン200ml を注入し、撹拌、静置した。有機層を分取し、水洗 (20 0ml×2)、無水硫酸マグネシウムで乾燥、乾燥剤を濾 別後、溶剤留去して得られた残渣30gをtert-ブチルカ テコール(重合禁止剤)を添加して減圧蒸留し、bp. 93 ~96℃/1 mmHg留分のp-(1-エトキシエトキシ) スチレ ン21.5gを無色油状物として得た。

I R (Neat) ν c m⁻¹ : 2970, 2930, 2890, 1635 (C=C), 1605, 1505,

元素分析值(C12H16O2)

理 論 値 : C% 74.97 ; H% 8.3 9

 実 測 値
 C% 75.08
 H% 8.3

 3

【0073】(3)p-(1-エトキシエトキシ) スチレンの 重合

上記(2)で得られたp-(1-エトキシエトキシ) スチレン 19.2gに触媒量の2.2'-アゾビスイソブチロニトリルを 添加してトルエン溶剤中、窒素気流下、80℃で6時間重 合反応させた。冷却後、反応液をメタノール1000ml中に 50 撹拌下注入し、静置、デカントして得た粘稠油状物を更にメタノール500mlで2回洗浄した後、減圧濃縮して残渣のポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレン] 16.3gを微黄色粘稠油状物として得た。 本品はGPC測定(ポリスチレン標準)した結果、重量平均分子量(Mw)約10000、数平均分子量(Mn)約5500であった。

20

【0074】(4)ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン--p-ヒドロキシスチレン] の合成

上記(3)で得たポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン] 15.5gを1,4-ジオキサン150mlに溶解し、シュウ酸 1.6gを加えて3時間撹拌還流させた。冷却後、反応液を水1000ml中に注入、撹拌晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] 12.0gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp- (1-エトキシエトキシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は 1 H NMR測定 (5.2~5.4ppmのメチン水素と6.2~6.8ppmの芳香環水素の積分比より算出)により約1:1であった。重量平均分子量約8500、 1 Mw/ 1 Mn = 1.8 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0075】製造例2. ポリ [p- (1-エトキシエトキシントキシンテーとドロキシスチレン] の合成

「方法-2] 製造例1の(2)で得たp-(1-エトキシエトキシ)スチレン9.6 g及びp-ヒドロキシスチレン6.0 gを用いて製造例1の(3)と同様にして重合反応を行った後、反応液を石油エーテル1000ml中に注入、晶析させ、析出晶を遮取、洗浄、減圧乾燥してポリ [p-(1-エトキシエトキシ)スチレンーp-ヒドロキシスチレン]12.8 gを白色粉末晶として得た。得られた共重合体p-(1-エトキシエトキシ)スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位は¹HNMR測定より約1:1であった。重量平均分子量約9000、Mw/Mn≒2.0 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0076】製造例3. ポリ [p-(1-エトキシエトキシン スチレンーp-ヒドロキシスチレン] の合成 [方法-3]

(1)p-tert-ブトキシスチレンの重合

(17)Ptert-フトモンステレンの重音 p-tert-ブトキシスチレン17.6gに触媒量の2,2'-アゾビスイソブチロニトリルを添加してトルエン溶剤中、窒素 50元下、80℃で6時間重合反応させた。反応液を冷却後、メタノール1000ml中に注入、晶析させ、析出晶を膨取、メタノール洗浄、減圧乾燥してポリ(p-tert-ブトキシスチレン)15.5gを白色粉末晶として得た。重量平均分子量約10000(GPC法:ポリスチレン標準)。 【0077】(2)ポリ(p-ヒドロキシスチレン)の合成上記(1)で得たポリ(p-tert-ブトキシスチレン)15.0gを1,4-ジオキサンに溶解し、濃塩酸10mlを加えて4時間撹拌還流させた。冷却後、反応液を水1000ml中に注

入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリ (p-ヒドロキシスチレン) 9.7gを白色粉末晶として得

た。

【0078】(3)ポリ [p-(I-エトキシエトキシ) スチ レンーp-ヒドロキシスチレン]の合成

上記(2)で得たポリ (p-ヒドロキシスチレン) 4.0g及 びエチルビニルエーテル 1.5gを1,4-ジオキサンとピリ ジンの混合液35mlに溶解し、これに触媒量のp-トルエン スルホン酸を添加し、室温で24時間撹拌反応させた。反 応後、水1000ml中に反応液を注入、晶析させ、析出晶を 濾取、水洗、減圧乾燥してポリ [p-(1-エトキシエトキ シ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] 5.0gを白色粉 末晶として得た。得られた重合体のp-(1-エトキシエト キシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成 比は¹HNMR測定により約1:1であった。重量平均 分子量約 10000 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0079】製造例4. ポリ [p- (1-エトキシエトキ シ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] の合成

[方法-4] ポリ (p-ヒドロキシスチレン) [丸善石油 化学(株)、重量平均分子量約 10000、数平均分子量約 5000:商品名 マルカリンカーM] 8.0 g及びエチルビ ニルエーテル3.0 gを1,4-ジオキサン70mlに溶解し、p- 20 トルエンスルホン酸・ピリジン塩0.5 gを添加して室温 下、24時間撹拌反応させた。反応後、水中に反応液を注 入し、撹拌晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥し てポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロ キシスチレン] 10.0gを白色粉末晶として得た。得られ た重合体のp-(1-エトキシエトキシ)スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より 約1:1であった。重量平均分子量約 11000 (GPC 法:ポリスチレン標準)。

【0080】製造例5. ポリ [p-(1-エトキシエトキ シ) スチレン--p-ヒドロキシスチレン] の合成 上記製造例3の(2)で得たポリ (p-ヒドロキシスチレ ン) 4.0 g及びエチルビニルエーテル1.5 gをアセトン に溶解し、これに触媒量の硫酸・ピリジン塩を添加し、 室温で12時間撹拌反応させた。次いで反応液を水1000ml 中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥し てポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロ キシスチレン] 3.9 gを白色粉末晶として得た。得られ た重合体のp-(1-エトキシエトキシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より 約35:65であった。重量平均分子量約 10000 (GPC 法:ポリスチレン標準)。

【0081】製造例6. ポリ [p-(1-メトキシエトキ シ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] の合成 [方法-1]

(1)p-ブロム-(1-メトキシエトキシ)ベンゼンの合成 p-ブロムフェノール17.3g (0.1 モル)及びメチルビニ ルエーテル14.0g (0.2 モル) を用いて製造例1の(1) と同様に実施し、得られた粗油状物24g減圧蒸留してb

キシ) ベンゼン20.8gを微黄色油状物として得た。 1 H N M R δ ppm (CDCl₃) : 1.46 (3H, d, J=5.4Hz, O $CHC\underline{H}_3$) 、 3. 37 (3H, s, $-OC\underline{H}_3$) 、 5. 29 (1H, q, J =5.5Hz, OCHCH3)、6.86 (2H, d, J=8.8Hz, 芳香環 2-H, 6-H) 、7. 36 (2H, d, J=8. 8Hz, 芳香環 3-H, 5-H)。 IR (Neat) ν c m₋₁: 3000, 2940, 2850, 1590, 1580, 1490

【0082】(2)p-(1-メトキシエトキシ) スチレンの 合成

上記(1)で得たp-ブロム-(1-メトキシエトキシ)ベン ゼン11.6gを用いて、製造例1の(2)と同様に実施し、 得られた粗油状物10.7gをp-tert-ブチルカテコール存 在下で減圧蒸留して、bp. 86~87℃/3 mmHg留分のp-(1-メトキシエトキシ) スチレン8.8 gを無色油状物と して得た。

 1 H N M R 0 0 ppm (CDCl₃) : 1.46 (3H, d, J=5.5Hz, O $CHC\underline{H}_3$) 、 3. 37 (3H, s, $-C\underline{H}_3$) 、 5. 12 (1H, d, J=1 1Hz, CH2 = CH-)、5.30 (1H, q, J=5.1Hz及び 5.5H z, $OC\underline{H}CH_3$), 5.60 (1H, d, J=17.6Hz, $C\underline{H}_2 = C$ H-)、6.64 (1H, dd, J=11Hz及びJ=17.6Hz, CH₂ = C <u>H</u>-)、6.95(2H, d, J=8.8Hz,芳香環3-H, 5-H)、7.32 (2H, d, J=8.8Hz, 芳香環 2-H, 6-H)。

I R (Neat) ν c m⁻¹: 2980, 2920, 2820, 1620 (C=C), 1600, 1500.

元素分析値(C11H14O2)

理 論 値 : C% 74.13 H% 2

実 測 値 : C% 74.41 ; H% 7.8

30 【0083】(3)p-(1-メトキシエトキシ) スチレンの

上記(2)で得たp-(1-メトキシエトキシ) スチレン8.0 gを用いて、製造例1の(3)と同様に実施し、ポリ [p-(メトキシエトキシ) スチレン] 7.2 gを微黄色粘稠油 状物として得た。重量平均分子量約 10000、数平均分子 量約5000 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0084】(4)ポリ [p-(1-メトキシエトキシ) スチ レンーp-ヒドロキシスチレン]の合成上記(3)で得たポ リ [p- (1-メトキシエトキシ) スチレン] 6.2 gを用い て、製造例1の(4)と同様に実施し、ポリ [p-(1-メト キシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] 3.0 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp- (1-メ トキシエトキシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン 単位の構成比は HNMR測定より約45:55であった。 重量平均分子量9000、Mw/Mn≒1.8 (GPC法:ポリス チレン標準)。

【0085】製造例7. ポリ [p-(1-メトキシー1-メチ ルエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] の合成 上記製造例3の(2)と同様にして得たポリ (p-ヒドロキ p.89 ~90℃/2 mmHg留分のp-ブロム-(1-メトキシエト 50 シスチレン)4.0 g及び2-メトキシ-1-プロペン4.8 g

を1,4-ジオキサンとピリジンの混合液35mlに溶解し、これに触媒量のクロルスルホン酸を添加し、室温で20時間 撹拌反応させた。反応後、反応液を製造例2の(3)と同様にして処理し、ポリ [p- (1-メトキシー1-メチルエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] 4.1 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp- (1-メトキシー1-メチルエトキシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より約1:1であった。重量平均分子量約 10000 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0086】製造例8.ポリ [p-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレンーp-ヒドロキシスチレン]の合成上記製造例3の(2)と同様にして得たポリ (p-ヒドロキシスチレン)4.8 g及びn-ブチルビニルエーテル3.0 gを1,4-ジオキサンとピリジンの混合液50mlに溶解し、これに触媒量の硫酸を添加し、室温で16時間撹拌反応させた。反応後、反応液を製造例2の(3)と同様にして処理し、ポリ [p-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレンーp-ヒドロキシスチレン]4.2 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレン単20位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は1HNMR測定より4:6であった。重量平均分子量約10000(GPC法:ポリスチレン標準)。

【0087】製造例9. ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンーフマロニトリル] の合成

(1)ポリ (p-tert-ブトキシスチレン一フマロニトリル) の合成

p-tert-ブトキシスチレン28.2g (0.16モル)及びフマロニトリル3.1 g (0.04モル)を触媒量の2,2'-アゾビス (2-メチルプロピオン酸メチル)の存在下、トルエン溶剤中、窒素気流下90℃で2時間重合反応させた。反応後、反応液をメタノール中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、洗浄、乾燥してポリ (p-tert-ブトキシスチレンーフマロニトリル) 21.3gを白色粉末晶として得た。

【0088】(2)ポリ (p-ヒドロキシスチレンーフマロニトリル) の合成

上記(1)で得たポリ (p-tert-ブトキシスチレンーフマロニトリル) 20.0gを用いて、製造例3の(2)と同様に反応及び後処理を行い、ポリ (p-ヒドロキシスチレンー 40フマロニトリル) 10.6gを白色粉末晶として得た。重量平均分子量約10000 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0089】(3)ポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンーフマロニトリル] の合成上記(2)で得たポリ (p-ヒドロキシスチレンーフマロニトリル) 9.0 g及びエチルビニルエーテル3.0 gを用いて、製造例3の(3)と同様に反応及び後処理を行い、ポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンーフマロニトリル] 8.8 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-(1-エトキシエトキシ) スチ 50

レン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より約4:6であった。重量平均分子量約 110 00 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0090】製造例10. ポリ [p-(1-エトキシエトキシン スチレンーp-ヒドロギシスチレンーメタクリル酸 tert-ブチル] の合成

(1)ポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレンーメタク リル酸 tert-ブチル] の合成

製造例1の(2)で得たp-(1-エトキシエトキシ)スチレン17.3g(0.09モル)及びメタクリル酸 tert-ブチル1.4 g(0.01モル)に触媒量の2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルプロピオン酸メチル)を添加してトルエン溶剤中、窒素気流下80℃で8時間重合反応させた。反応液を冷却後、石油エーテル中に撹拌下注入し、静置、デカントして得た粗粘稠油状物をメタノール500mlで2回洗浄した後、減圧濃縮して残渣のポリ[p-(1-エトキシエトキシ)スチレンーメタクリル酸 tert-ブチル]15.5gを微黄色粘稠油状物として得た。重量平均分子量約12000(GPC法:ポリスチレン標準)。

【0091】(2)ポリ [p-(1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸tert-ブチル] の合成

上記(1)で得たポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーメタクリル酸 tert-ブチル] 12.0gを1,4-ジオキサンに溶解し、p-トルエンスルホン酸 0.5gを加えて80℃で30分間撹拌反応させた。冷却後、反応液を水1000ml中に注入、撹拌晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸 tert-ブチル] 9.8 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp- (1-エトキシエトキシ) スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は¹HNMR測定した結果、約35:65であった。重量平均分子量約 11000 (GPC法:ポリスチレン標準)。

【0092】参考例1.ポリ (p-テトラヒドロピラニルオキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン)の合成ポリ (p-ヒドロキシスチレン) [丸善石油化学(株)、重量平均分子量約 10000、数平均分子量約5000:商品名マルカリンカーM]9.0 gをジメトキシエタン100mlに溶解し、次いで3,4-ジヒドロ-2H-ピラン12.6g及び硫酸 0.5mlを加え30~40℃で15時間撹拌した。反応後、反応液を減圧濃縮し、残渣を炭酸ナトリウムで中和し、水1000ml中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥してポリ (p-テトラヒドロピラニルオキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) 11.0gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-テトラヒドロピラニルオキシスチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より約3:7であった。重量平均分子量約10000(GPC法:ポリスチレン標準)。

【0093】参考例2. ポリ (p-tert-ブトキシスチレ

ン-p-ヒドロキシスチレン) の合成

ポリ(p-ヒドロキシスチレン) [丸善石油化学(株)、 重量平均分子量約 10000、数平均分子量約5000:商品名 マルカリンカーM] 4.0 g及びジメトキシエタン70ml を耐圧容器に入れ、これにイソブチレン60 g及び硫酸 0.3 gを−60℃以下で加えた後、45℃で1 時間、次いで 室温で22時間撹拌反応させた。反応後、反応液を濃縮 し、残渣を炭酸ナトリウムで中和し、水1000ml中に注 入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、減圧乾燥して ポリ(p-tert-ブトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン ン)4.1 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体の p-tert-ブトキシスチレン単位とp-ヒドロキシスチレン 単位の構成比は¹HNMR測定より約1:1であった。 重量平均分子量約 10000(GPC法:ポリスチレン標 進)

【0094】参考例3. ポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) の合成 (1)米国特許第4,491,628号 (1985年) に記載の方法に従って得られたp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン22g (0.1 モル) を用いて2,2'ーアゾビス (2,4-ジ 20メチルワレロニトリル) 触媒存在下、トルエン中窒素気流下、90℃で4 時間重合反応させた。反応液を冷却後、メタノール中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、メタノール洗浄、減圧乾燥してポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン) 15.2gを白色粉末晶として得た。重量平均分子量約12000(GPC法:ポリスチレン標準)。

【0095】(2)上記(1)で得たポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン) 7.0 gを1,4-ジオキサンに溶解し、濃塩酸5mlを加えて1.5時間撹拌還流させた。冷却後、反応液を水1000ml中に注入、晶析させ、析出晶を遮取、水洗、減圧乾燥してポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) 4.8gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は HNMR 測定より約1:1であった。重量平均分子量約9500(GPC法:ポリスチレン標準)。

【0096】参考例4.2-(シクロヘキシルカルボニル)-2-(p-トルエンスルホニル)プロパンの合成(1)金属マグネシウム(削り状)23.9g(0.98原子)をエチルエーテルに懸濁させ、これに撹拌還流下ブロムシクロヘキサン160g(0.98モル)を滴下し、次いで1時間撹拌還流させた。冷却後、得られたグリニャール試薬をイソ酪酸クロライド95g(0.89モル)のエチルエーテル溶液に-5~0℃で滴下し、同温度で3時間撹拌反応させた後、室温で一夜放置した。反応液を水中に注入し、分離したエーテル層を分取し、水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶剤を留去し、残渣を減圧蒸留してbp.95~100℃/20mmHg留分の1-シ

クロヘキシル-2-メチル-1-プロパノン50 g を微黄色油状物として得た。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃): 1.06 (6H, d, C \underline{H}_3 × 2)、1.12~1.87 (10H, m, シクロヘキサン環C \underline{H}_2 × 5)、2.51 (1H, m, シクロヘキサン環C \underline{H})、2.76 (1H, m, C \underline{H})。

IR (Neat) ν c m⁻¹: 1710 (C=0)

【0097】(2)上記(1)で得た1-シクロヘキシル-2-メチル-1-プロパノン47.6g (0.31モル)に塩化スルフ 10 リル42g (0.31モル)を25~35℃で滴下した後、50℃で3.5 時間撹拌反応させた。反応液を濃縮後、減圧蒸留してbp.99~100℃/18mmHg留分の2-クロル-1-シクロヘキシル-2-メチル-1-プロパノン30.1gを黄色油状物として得た。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.18~1.87 (16H, m, C \underline{H} ₃ × 2及びシクロヘキサン環C \underline{H} ₂ × 5) 、3.13 (1H, m, シクロヘキサン環C \underline{H}) 。

【0098】(3)上記(2)で得た2-クロルー1-シクロヘキシルー2-メチルー1-プロパノン30.0g (0.16モル)のジメチルスルホキシド (DMSO) (320m1)溶液にpートルエンスルフィン酸ナトリウム30.0g (0.17モル)を加え、60℃で20時間撹拌反応させた。反応液を冷水中に注入し、0~5℃で1時間撹拌した後、析出晶を遮取、水洗、乾燥して得た粗結晶18gをnーヘキサンーベンゼン混液から再結晶して2-(シクロヘキシルカルボニル)-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン13.5gを白色針状晶として得た。 mp. 123~123.5℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃):1.19~1.91 (16H, m, C<u>H</u> ₃×2及びシクロヘキサン環C<u>H</u>₂×5)、2.45 (3H, 30 s, Ph-C<u>H</u>₃)、3.25 (1H, m, シクロヘキサン環C <u>H</u>)、7.33 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 3-H, 5-H)、7.65 (2 H, d, J=8Hz, 芳香環 2-H, 6-H)。

IR (KBr) ν c m⁻¹: 1705 (C=0), 1310 $_{\circ}$

【0099】参考例5.2-メチルー2-(p-トルエンスルホニル)プロピオフェノンの合成イソブチロフェノン29.6g(0.2 モル)を用いて、参考例4の(2)及び(3)と同様にして反応及び後処理を行い、粗結晶をメタノールから再結晶して2-メチルー2-(p-トルエンスルホニル)プロピオフェノン21.2gを白色針状晶として得た。mp.64~64.5℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃):1.70 (6H, s, C<u>H</u>₃ × 2)、2.45 (3H, s, Ph – C<u>H</u>₃)、7.32 (2H, d, J=7H z, p-メチルベンゼン環 3–H, 5–H)、7.44 (2H, t, J=7H z, 芳香環 3–H, 5–H)、7.54 (1H, t, J=7Hz, 芳香環 4–H)、7.67 (2H, d, J=7Hz, 芳香環 2–H, 6–H)、7.95 (2H, d, J=7Hz, 芳香環 2–H, 6–H)。

IR (KBr) ν c m⁻¹: 1680, 1303, 1290,

【0100】参考例6.2,4-ジメチル-2-(p-トルエンスルホニル)ペンタン-3-オンの合成

50 ジイソプロピルケトン22.8g (0.2 モル) を用いて、参

考例4の(2)及び(3)と同様にして反応及び後処理を行 い、粗結晶をn-ヘキサンーベンゼン混液から再結晶して 2,4-ジメチル-2-(p-トルエンスルホニル)ペンタン-3-オン16.5gを白色鱗片状晶として得た。 mp. 76~79 C.

 1 HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.15 (6H, d, C $_{H_3}$ \times 2) 1.55 (6H, s, C $\underline{H}_3 \times 2$) 2.45 (3H, s, P h - $C_{\underline{H}_3}$) 、 3. 54 (1H, m, J=7Hz, $C_{\underline{H}}$) 、 7. 34 (2H, d, J=8 Hz, 芳香環 3-H, 5-H) 、7.65 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 2-H, 6-H) \circ I R (KBr) ν c m₋₁: 1715 (C=0), 1305, 1290

【0101】参考例7. ビス(シクロヘキシルスルホニ ル) ジアゾメタンの合成

(1)アジ化ナトリウム22.5g (0.35モル) を少量の水に 溶解した後、90%含水エタノール130mlで希釈した。次 いで10~25℃でp-トルエンスルホニルクロライド60g

(0.32モル)を溶解したエタノール(300ml)溶液を 滴下し、室温下2.5時間反応させた。次いで反応液を減 圧濃縮し、残渣油状物を数回水洗した後、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、p-トルエンスル 20 ホニルアジド50.7gを無色油状物として得た。

 $^{1}HNMR$ δ ppm (CDCl₃) : 2.43 (3H, s, C \underline{H}_{3}) , 7. 24 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 3-H, 5-H) 、7. 67 (2H, d, J=8 Hz, 芳香環 2-H, 6-H)。

IR (Neat) ν cm⁻¹: 2120(N₃) .

【0102】(2)シクロヘキサンチオール20.2g (0.17 モル)に水酸化カリウム12.0g(0.21モル)のエタノー ル(50ml)溶液を室温下滴下し、30±5℃で30分撹拌反応 させた。次いで塩化メチレン18.2g (2.14モル)を注入 し、50±5℃で6時間撹拌反応させた。室温で一夜放置 後、反応液にエタノール55mlを注入、希釈し、タングス テン酸ナトリウム 400mgを添加した後、30%過酸化水素 水50g (0.44モル) を45~50℃で滴下、更に同温度で4 時間撹拌反応させた。反応後、水200mlを注入し室温下 一夜放置し、析出晶を濾取、水洗、乾燥して得た粗結晶 22gをエタノールから再結晶してビス (シクロヘキシル スルホニル)メタン15.5gを白色針状晶として得た。 mp. 137 ~139 ℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.13~2.24 (20H, m, シク ロヘキサン環CH₂×10)、3.52~3.66 (2H, m, シクロ 40 ヘキサン環C<u>H</u>)、4.39(2II, s, C<u>H</u>2)。

I R (KBr) $v c m^{-1}$: 1320, 1305 .

【0103】(3)水酸化ナトリウム1.7 gを60%含水エ タノール70m1に溶解し、これに上記(2)で得たビス (シ クロヘキシルスルホニル) メタン12.1g (0.04モル) を 添加した。次いで上記(1)で得たp-トルエンスルホニル アジド8.2 g (0.04モル) のエタノール(10ml)溶液を5 ~10℃で滴下、次いで室温で7時間撹拌反応させた。室 温で一夜放置後、析出晶を濾取し、エタノール洗浄、乾

ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン8.0 g を微黄色プリズム晶として得た。 mp. 130 ~131 ℃。 ¹HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.13~2.25 (20H, m, シク ロヘキサン環C<u>H</u>2 ×10) 、3.36~3.52 (2H, m, シクロ ヘキサン環C<u>H</u>×2)。

IR (KBr) $v c m^{-1}$: 2130(CN₂), 1340, 1320

【0104】参考例8. メチルスルホニル p-トルエン スルホニルジアゾメタンの合成

(1)メチルチオメチル p-トリルスルホン6.0 g (0.03 10 モル)をメタノール40ml及び水40ml中に溶解し、タング ステン酸ナトリウム60mgを添加した後、30%過酸化水素 水 6.8g (0.06モル) を45~50℃で滴下し、次いで撹拌 還流下10時間反応させた。室温下一夜放置後、水 400ml 中に反応液を注入し、析出晶を濾取、水洗、乾燥し、得 られた粗結晶7.2 gをエタノールから再結晶してメチル スルホニルp-トルエンスルホニルメタン6.1gを白色針 状晶として得た。mp. 163.5 ~165℃。

 1 HNMR δ ppm (CDCl₃) : 2.48 (3H, s, Ph - C \underline{H}_3) 3.28 (3H, s, C \underline{H}_3) 4.56 (2H, s, C \underline{H}_2) 7.40 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 3-H, 5-H) 、7.87 (2H, d, J=8H z, 芳香環 2-H, 6-H)。

【0105】(2)上記(1)で得たメチルスルホニル p-トルエンスルホニルメタン 5.0g (0.02モル) を用いて 参考例7の(3)と同様にして反応及び後処理を行い、得 られた粗結晶 3gをエタノールから再結晶してメチルス ルホニル p-トルエンスルホニルジアゾメタン 2.2gを 微黄色鱗片状晶として得た。 mp. 107.5 ~109 ℃。 1 HNMR δ ppm (CDCl₃) : 2.46 (3H, s, Ph – C $_{H_{3}}$)、3. 42(3H, s, C <u>H</u>₃)、7. 38(2H, d, J=8Hz,芳香環 3-H, 5-H) 、7.87 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 2-H, 6-H)。 IR (KBr) ν c m⁻¹: 2120 (CN₂), 1350, 1330 $_{\circ}$

【0106】参考例9.ビス(I, I-ジメチルエチルスル ホニル) ジアゾメタンの合成

tert-ブチルメルカプタン18.0g (0.2 モル) を用い て、参考例7の(2)及び(3)と同様にして反応及び後処 理を行い、得られた粗結晶をエタノールから再結晶して ビス(1,1-ジメチルエチルスルホニル)ジアゾメタン8. 5 gを微黄色針状晶として得た。mp. 121 ~121.5 ℃。 1 HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.52 (18H, s, C $_{H_3}$ \times 6) .

I R (KBr) ν c m⁻¹: 2120 (CN₂), 1330, 1315 . 【0107】参考例10.1-ジアゾ-1-シクロヘキシル スルホニル-3,3-ジメチル-2-ブタノンの合成 (1)シクロヘキサンチオール23g (0.198 モル) 中に水 酸化カリウム13.7g(0.207モル)のエタノール(80m 1) 溶液を15℃で滴下し、同温度で24時間撹拌した。次 いで1-ブロム-3,3-ジメチル-2-ブタノン35.4g (0.198 モル)を10~15℃で滴下した後、20℃で5時間撹拌反応 させた。更にタングステン酸ナトリウム2.5gを添加し 燥して得た粗結晶11gをアセトニトリルから再結晶して 50 た後、30%過酸化水素水220g(1.96モル)を45~50℃

で滴下し $60\sim80$ ℃で30時間反応させた。冷却後、塩化メチレン抽出(300ml×1)し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、溶剤を留去して粗1-シクロヘキシルスルホニル-3,3-ジメチル-2-ブタノン14gを微黄色油状物として得た。 1 HNMR δ ppm($CDCl_3$): $1.10\sim2.19$ (19H, m, $C\underline{H}_3$ × 3 及びシクロヘキサン環 $C\underline{H}_2$ × 5)、 $3.37\sim3.53$ (1H, m, シクロヘキサン環 $C\underline{H}_1$)、4.12(2H, s, $C\underline{H}_2$)。

I R (Neat) ν c m⁻¹: 1700 (C=0), 1310_o

【0108】(2)上記(1)で得た粗1-シクロヘキシルス 10 ルホニル-3,3-ジメチル-2-ブタノン13g (53ミリモル) 及びトリエチルアミン6.14g(61ミリモル)をエタノー ル40mlに溶解し、参考例7の(1)で得たp-トルエンスル ホニルアジド11.4g (58ミリモル)を0~5℃で滴下 し、10~20℃で8時間撹拌反応させた。室温で一夜放置 後、反応液を減圧濃縮し、残渣にエチルエーテル250ml を注入し、有機層を5%水酸化カリウム水溶液 (100m 1) で2回、次いで飽和食塩水(100ml)で1回洗浄し、 無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、溶 剤留去して得た粗油状物15gをカラムクロマトグラフィ 20 [充填剤:ワコーゲル C-200 (和光純薬工業(株)商 品名)、溶離液:n-ヘキサン/塩化メチレン=7/1→ 4/1→2/1]により分離した後、n-ヘキサン-エチ ルエーテル混液から再結晶し1-ジアゾ-1-シクロヘキシ ルスルホニル-3,3-ジメチル-2-ブタノン2.5 gを微黄色 針状晶として得た。 mp. 80.5~82.0℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃) : 1.05~2.16 (19H, m, C \underline{H} ₃ × 3及びシクロヘキサン環 C \underline{H} ₂ × 5) 、3.52~3.66 (1H, m, シクロヘキサン環 C \underline{H}) 。

I R (KBr) ν c m⁻¹: 2105 (CN₂), 1650 (C=0), 1320 (S0 $_2$)

【0109】参考例11. l-ジアゾ-l-メチルスルホニル-4-フェニル-2-ブタノンの合成

I R (Neat) ν c m⁻¹: 1745(CO₂) $_{\circ}$

【0110】(2)ジメチルスルホン42g (0.45モル)をDMSO 225mlに溶解し、60%水素化ナトリウム17.9g (0.45モル)を18~20℃で少量ずつ添加し、65~70℃で30分間撹拌反応させた後、テトラヒドロフラン 225mlを注入し、希釈した。次いで上記(1)で得た3-フェニルプロピオン酸メチル36.6g (0.22モル)のテトラヒドロフラン (110ml)溶液を33~41℃で滴下し、撹拌還流下に1時間反応させた。反応液を冷却後、希塩酸水溶液中に

¹HNMR δ ppm (CDCl₃) : 2.91~3.09 (7H, m, C<u>H</u>₂ × 2及びC<u>H</u>₃)、3.99 (2H, s, C<u>H</u>₂)、7.16~7.33 (5H, m, 芳香環)。

IR (KBr) ν c m⁻¹: 1730 (C=0), 1320, 1305

【0111】(3)上記(2)で得た1-メチルスルホニル-4-フェニル-2-ブタノン12g(0.05モル)を塩化メチレン135mlに溶解し、トリエチルアミン11.5gを滴下した後、30分間撹拌反応させた。次いで参考例7の(1)で得たp-トルエンスルホニルアジド11.5g(0.06モル)を0~5℃で滴下し、同温度で5時間撹拌反応させた。反応液を濃縮して得た粗固形物26.6gを四塩化炭素から再結晶して1-ジアゾ-1-メチルスルホニル-4-フェニル-2-ブタノン7.5gを微黄色針状晶として得た。mp.52.5~54℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃): 2.88~3.07 (4H, m, C<u>H</u>₂ × 2)、3.17 (3H, s, C<u>H</u>₃)、7.16~7.35 (5H, m, 芳香環)。

I R (KBr) ν c m⁻¹: 2120(CN₂), 1655(C=0), 1335, 131 5 $_{\circ}$

【0112】参考例12.1-ジアゾ-1-(p-トルエンスルホニル)-3,3-ジメチル-2-ブタノンの合成

(1)1-ブロム-3,3-ジメチル-2-ブタノン33.3g (0.19年30 ル)をDMSO 330mlに溶解し、これにp-トルエンスルフィン酸ナトリウム34.9g (0.20モル)を30~40℃で添加した。次いで60~70℃で18時間撹拌反応させた後、反応液を氷水2000m1中に注入し、析出晶を濾取、水洗、乾燥して1-(p-トルエンスルホニル)-3,3-ジメチル-2-ブタノン41.6gを白色結晶として得た。 mp. 119~122℃。

 1 HNMR δ ppm (CDC1₃) : 1.12 (9H, s, C \underline{H}_{3} × 3) 、2.45 (3H, s, C \underline{H}_{3}) 、4.31 (2H, s, C \underline{H}_{2}) 、7.36 (2H, d, J=8Hz、芳香環 3-H, 5-H) 、7.82 (2H, d, J=8Hz, 芳香環 2-H, 6-H) 。

I R (KBr) ν c m⁻¹: 1715(C=0), 1320, 1290 \circ

【0113】(2)上記(1)で得たI- (p-トルエンスルホニル)-3,3-ジメチル-2-ブタノン20g (0.08モル)を用いて参考例7の(3)と同様にして反応及び後処理を行い、得られた粗固形物24gをエタノールから再結晶してI-ジアゾ-I- (p-トルエンスルホニル)-3,3-ジメチル-2-ブタノン12.6gを微黄色短針状晶として得た。 mp. 120.5~121.5℃。

ラン(110ml)溶液を33~41℃で滴下し、撹拌還流下に ¹HNMR δppm (CDCl₃):1.17 (9H.s, C<u>H</u>₃ × 1 時間反応させた。反応液を冷却後、希塩酸水溶液中に 50 3)、2.44 (3H.s, C<u>H</u>₃)、7.34 (2H.d.J=8Hz、芳香環

3-H, 5-H) 、7.93 (2H, d, J=8Hz, 芳香環2-H, 6-H) 。 [R (KBr) ν c m⁻¹: 2140(CN₂), 1660, 1305 。

【0114】参考例13.1-アセチル-1-(1-メチル エチルスルホニル) ジアゾメタンの合成

(1)2-プロパンチオール12.2g(0.16モル)中に水酸化カリウム11.5g(0.174モル)のエタノール(100ml)溶液を15 ℃以下で滴下し、同温度で24時間攪拌した。次いでクロルアセトン23.1g(0.25モル)を10~15℃で添加した後、20℃で4時間攪拌反応させた。更に、タングステン酸ナトリウム0.8gを添加した後、30%過酸化水素水36gを(0.32モル)を45~55℃で滴下し室温で14時間攪拌反応させた。反応液を塩化メチレン抽出(200ml×1)し、有機層を分取し、水洗した後、無水酢酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、溶剤留去して粗1-(1-メチルエチルスルホニル)アセトン18.9gを黄褐色油状物として得た。

¹H NMR δ ppm (CDCl₃) : 1.40 (6H, d, J=7Hz) C $\underline{H}_3 \times 2$) 、 2.40 (3H, s, C \underline{H}_3) 、 3.30 (1H, m, C \underline{H}) 、 4.00 (2H, s, C \underline{H}_2)

IR (Neat) $v c m^{-1}$: 1310, 1110,

【0115】(2)上記(1)で得た粗1-(1-メチルエチルスルホニル)アセトン8.65g(53ミリモル)及びトリエチルアミン6.14g(61ミリモル)をエタノール40m1に溶解し、参考例7の(1)で得たp-トルエンスルホニルアジド11.4g(58ミリモル)を0~5℃で滴下し、10~20℃で5時間攪拌反応させた。室温で一夜放置後、反応液を減圧濃縮し、残渣に塩化メチレン200m1を注入し、有機層を5%水酸化カリウム水溶液(200m1)で1回、水(200m1)で3回洗浄した後、溶剤留去して得た残渣12.4gをカラムクロマトグラフィ[充填剤:ワコーゲルC-200](和光純薬工業(株)商品名)、溶離液:n-ヘキサン/塩化メチレン=4/1→1/1]により分離した後、n-ヘキサンーエタノール混液から再結晶して1-アセチル-1-

(1-メチルエチルスルホニル) ジアゾメタン2.6gを微 黄色短針状晶として得た。mp.53.0~55.0℃。

¹ H NMR δ ppm (CDCl₃) : 1.44 (6H, d, J=7Hz C \underline{H} 3 × 2) , 2.39 (3H, m, C \underline{H} 3) , 3.51 (1H, m, C \underline{H}) 。 I R (KBr) ν c m⁻¹ : 2140 (CN₂) , 1330 (SO₂) , 114 0。

【0116】参考例14. p-トルエンスルホン酸 2,6- 40 ジニトロベンジルの合成

(1)2,6-ジニトロベンズアルデヒド19.6g (0.1 モル)をメタノール 200ml中に懸濁させ、15~25℃で水素化ホウ素ナトリウム 5.8gを徐々に添加した後、室温で1時間撹拌反応させた。反応後、溶剤留去し、残渣に水 100ml及びクロロホルム 100mlを加え、1時間撹拌反応させた後、静置、分液し、クロロホルム層を水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶剤を留去して、2,6-ジニトロベンジルアルコール15.0gを黄色結晶として得た。mp. 92.5~93.5℃。

¹HNMR δ ppm (CDCl₃): 2.77 (1H. t, J=7Hz, O <u>H</u>)、4.97 (2H, d, J=7Hz, C<u>H</u>₂)、7.66 (1H, t, J=8H z. 芳香環 4-H)、8.08 (2H, t, J=8Hz, 芳香環 3-H, 5-H)。

【0117】(2)上記(1)で得た2,6-ジニトロベンジルアルコール14.9g (0.075 モル)とp-トルエンスルホニルクロライド15.7g (0.083 モル)をアセトン 150mlに溶解し、これにジシクロヘキシルアミン15gのアセトン (25ml)溶液を0~10℃で滴下し、次いで室温下4時間撹拌反応させた。反応後、析出物を濾別し、濾液を濃縮して得た、残渣 (29g)を四塩化炭素から再結晶してp-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル19.8gを微黄色鱗片状晶として得た。mp. 98~99℃。

 1 H N M R δ ppm (CDC1 $_3$) : 2.45 (3H, s, C $_{\rm H_3}$)、5.57 (2H, s, C $_{\rm H_2}$)、7.34 (2H, d, J=8Hz, p-メチルベンゼン環 3-H, 5-H)、7.68 (1H, t, J=8Hz, ジニトロベンゼン環 4-H)、7.72 (2H, d, J=8Hz, p-メチルベンゼン環 2-H, 6-H)、7.72 (2H, d, J=8Hz, ジニトロベンゼン環 3-H, 5-H)。

20 I R (KBr) ν c m⁻¹: 1680, 1303, 1290_o

【0118】参考例15. 2-ジアゾ-2-ベンゼンスルホニル酢酸 シクロヘキシルの合成

(1)プロム酢酸 シクロヘキシル15.6g (70.5ミリモル)をDMSO(120m1)に溶解し、ベンゼンスルフィン酸ナトリウム・2水和物15g(75ミリモル)を20~40℃で少量ずつ添加し、60℃で6時間攪拌反応させた。冷却後、反応液を氷水1500m1中に注入し、析出晶を遮取、水洗、乾燥してベンゼンスルホニル酢酸 シクロヘキシル1.53gを白色結晶として得た。mp. 35~38℃

¹HNMR δppm (CDCl₃):1.11~1.82 (10H, m, シクロヘキサン環 C <u>H</u>₂)、4.11 (2H, s, C <u>H</u>₂)、4.64~4.8 2 (1H, m, C <u>H</u>)、7.50~7.98 (5H, m, 芳香環)。

I R (KBr) ν c m⁻¹: 1735 (C=0) ,1325 (SO₂) ,1295, 【0119】(2)上記(1)で得たベンゼンスルホニル酢 酸 シクロヘキシル10g(35ミリモル)を塩化メチレン100 mlに溶解し、トリエチルアミン4.2g(41ミリモル)を添 加した後30分間攪拌反応させた。次いで参考例7の(1) で得たp-トルエンスルホニルアジド8.3g(39ミリモル) を0~5℃で滴下し、同温度で4時間攪拌反応させた。 反応液を濃縮し、残渣にエチルエーテル250mlを注入、 溶解し、有機層を5%水酸化カリウム水溶液(200ml)で 1回、飽和食塩水(100ml)で1回洗浄後、無水酢酸マグ ネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、溶剤を留去して 得た残渣11gをカラムクロマトグラフィ〔充填剤:ワコ ーゲルC-200、溶離液:n-ヘキサン/塩化メチレン=6 /1→4/1→2/1→1/1]により分離して2-ジ アゾ-2-ベンゼンスルホニル酢酸 シクロヘキシル5.6g を微黄色結晶として得た。mp. 42.0~45.0℃。

 1 H N M R 0 δ ppm (CDC1 $_{3}$) : 1.11 \sim 1.82 (10H, m, シク 50 ロヘキサン環 C $_{1}$ H $_{2}$) 、4.02 \sim 4.90 (1H, m, シクロヘキサ

34 *【0120】実施例1. 製造例1及び製造例4で得たポ

リ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシ

スチレン]を各々下記の組成に調液した。

ン環C<u>H</u>)、7.47~8.07(5H, m, 芳香環)。 [R (Neat) ν c m⁻¹: 2160 (CN₂), 1730 (C=0), 1365 (S0₂) , 1310,

> ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] 3.0gジエチレングリコールジメチルエーテル 7.0g

上記の組成物を基板(石英ウェハー)上に回転塗布し、 90℃、90秒間ホットプレートでプレベーク後、1 μ mの 膜厚の重合体膜を得た。次いで各重合体膜のUV測定を 行った。そのUVスペクトルを図1に示す。図中、Iは 製造例1で得た重合体を用いて得られた重合体膜の紫外 10 【0121】実施例2. 下記の組成から成るフォトレジ 線分光曲線を示し、IIは製造例4で得た重合体を用いて 得られた重合体膜の紫外線分光曲線を示す。図1の結果※

※から、製造例1で得られた重合体は、製造例4で得た重 合体に比して、特にKrFエキシマレーザ光波長である 240 ~250 nm付近の光透過性が優れている(高透明性で ある)ことが判る。

スト材料を調製し、後述する如くしてパターン形成を行 った。

ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン]

(製造例1の重合体)

6.0g

2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン

(参考例4の酸発生剤)

0.3g

ジエチレングリコールジメチルエーテル

13.7 g

図2を用いて上記レジスト材料を使用したパターン形成 方法を説明する。半導体基板等1上に上記レジスト材料 -ク後、1.0 μ mの膜厚のレジスト材料膜を得た(図 2a)。次に248.4 nmのKrFエキシマレーザ光3をマス ク4を介して選択的に露光した(図2b)。そして100 ℃、90秒間ホットプレートでポストベーク後、アルカリ 現像液(2.38%テトラメチルアンモニウムハイドロオキ サイド水溶液)で60秒間現像することにより、レジスト 材料2の露光部のみを溶解除去し、ポジ型パターン2a を得た(図2c)。得られたポジ型パターンは 0.25μ m

ラインアンドスペースの解像性能を有しており、この時 の露光量は約 5mJ/cm²であった。又、本レジスト材料 2を回転塗布し、90℃、90秒間ホットプレートでプレベ 20 を用いて露光から加熱処理(ポストベーク)迄の時間経 過に対するパターン変化を測定したが8時間経過しても 0.25 μ mラインアンドスペースが全く問題なく解像され た。

【0122】実施例3~30

下記表1~4の各組成から成るフォトレジスト材料を夫 々調製した。

[0123]

【表1】

$\overline{}$	Y	
実施例3	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例 3 の重合体) 2- (シクロヘキシルカルポニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロバン (参考例 4 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	5.0g 0.3g 13.7g
実施例 4	ポリ [p- (1-メトキシ-1-メチルエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例7の重合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例4の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
実施例 5	ポリ [p- (1-メトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例 6 の壺合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例 4 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
実施例 6	ポリ [p- (1-n-プトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例8の重合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例4の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.3g 13.7g
実施例7	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例3の壁合体) ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン (参写例7の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.4 g 13.6 g
実施例8	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例3の重合体) p-トルエンスルホン酸 2,6-ジニトロベンジル : (参考例14の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	5.0 g 0.3 g 13.7 g
実施例9	ポリ [p- (l-メトキシ-1-メチルエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例7の重合体) ピス (1.1-ジメチルエチルスルホニル) ジアゾメタン (参考例9の設発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテルn	6.0g 0.3g 13.7g
寒 施 例 10	ポリ [p- (i-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例 3 の種合体) 2-メチル-2- (p-トルエンスルホニル) プロピオフェノン (参考例 5 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.5g 13.5g

[0124]

表 2

爽施例	(製造例5の革会体)	5.0g
ויס 11	1 = 1 (2) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2	
111	(参考例7の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3 g
<u> </u>	ブニノ じょう りょう ニルング テルエーテル	13.7 g
実施	(製造棚9の耐合体)	
例	2,4-ジメチル-2-(アトルエンスルホニル) ベンタンー3-オン	6.0 g
12	(参考例6の酵発生剤)	0.3g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7 g
実	## II [m. /1- + b + 2/ + b + 2/ + m.]	
施	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例4の叠合体)	_
19	「ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン	6.0 g
13	(参考例7の酸発生剤)	0.0-
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3 g 13.7 g
		10.18
実	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン]	
施	(製造例1の20合体)	6.0g
例 14	ピス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメラン	_
14	(0.4g
-	0-700773-10777101-710	13.6g
実	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン]	
施	(製造例4の競会体)	6.0g
例	2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン	v. v g
15	(参考例4の發発生剤)	0.3g
L_	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7g
実	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン]	
施	(製造例1の重合体)	
例	2-メチル-2- (p-トルエンスルホニル) プロピオフェノン	6.0g
16	(念老例5の砂砕片如)	0.3g
	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7 g
実	#11 [0. (1 = 1 + 1 = 1 + 1)	
施	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン]	ļ
(9)	(製造例 5 の重合体) ビス(1, 1-ジメチルエチルスルホニル)ジアソメタン	6.0g
17	(参考例9の酸発生剤)	
	ジエチレングリコールジメチルエーテルn	0.3g
		13.7 g
寒	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン-	1
施	メタクリル餃(tert-ブチル) (関語例(nの財合体)	6.0g
例 18	メチルスルホニル p-トルエンスルホニルジアゾメタン	
10	(参考例 8 の <mark>破発生剤)</mark> ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3g
		13.7 g

39

表 3

実施例 19	メタクリル酸 tert-プチル] (製造例10の重合体) 1-ジアゾ-1-シクロヘキシルスルホニル-3,3-ジメチルー2-ブタノン	6.0g 0.3g 13.7g
実施例 20	ポリ [p- (l-メトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例 6 の莖合体) 1-ジアゾ-l-メチルスルホニルー4-フェニル-2-ブタノン (参考例 1 1 の嵌発生剤)	5.0g 0.3g 13.7g
実施例 21	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例2の重合体) ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン (参考例7の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.4g 13.6g
実施例 22	ポリ [p- (1-メトキシ-1-メチルエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例7の重合体) ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン (参考例7の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.3g 13.7g
実施例 23	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例3の重合体) 1-ジアゾ-i- (p-トルエンスルホニル) -3.3-ジメチル-2-ブタノン (参考例12の酸発生剤) プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	6.0 g 0.3 g 13.7 g
実施例 24	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例 5 の重合体) 1-ジアゾ-1- (1, 1-ジメチルエチルスルホニル) -3, 3-ジメチル-2-ブタノン (参考例 1 2 の酸発生剤) 3 -メトキシプロピオン酸メチル	6.0g 0.4g 13.6g
実施例 25	ボリ [p~ (1-エトキシエトキシ) スチレンーp~とドロキシスチレン] (製造例 3 の重合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) - (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例 4 の酸発生剤)	6.0 g 0.3 g 13.7 g
実 施 例 26	ポリ [p- (1-メトキシ-1-メチルエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例 7 の重合体) 1-アセチル-1-(1-メチルエチルスルホニル) ジアゾメタン (参写例 1 3 の酸発生剤) プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	5.5 g 0.2 g 14.3 g

[0126]

実施例	ポリ [p- (1-n-ブトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例8の重合体) ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン	6. 0 g
27	(参考例7の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3 g 13.7 g
実施例 28	ポリ [p- (1-メトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例 6 の重合体) 2-ジアゾ-2-ベンゼンスルホニル酢酸 シクロヘキシル (参考例 1 5 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	5.8 g 0.2 g 14.0 g
実施例 29	ボリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンー メタクリル酸 tert-ブチル] (製造例 1 0 の重合体) p-トルエンスルホン酸 2.6-ジニトロベンジル (参考例 1 4 の酸発生剤) 乳酸エチル	6.0 g 0.1 g 13.9 g
実施例 30	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレンー フマロニトリル] (製造例 9 の歪合体) 1-アセチル-1-(1-メチルエチルスルホニル) ジアゾメタン (参考例 1 3 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g

【0127】上で調製した各レジスト材料を用いて夫々、実施例2と同様にしてパターン形成を行った。結果

を表5に示す。

[0128]

【表5】

43 表 5

44

実施例	宽光过 (ml/cm²	函光から加熱処理迄の時間と解像性能		
	(ш) (ш)	即時	3 0分	8時間
3	1 5	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S
4	2 0	0.30 µ m L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
. 5	8	0.25 μ m L/S	0.25 µ m L/S	0.25 µm L/S
6	1 5	0.30 μm L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
7	1 5	0.30 μ m L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
8	8	0.30 µ m L/S	0.30 µm L/S	0.30 µm L/S
9	1 6	0. 22 μ m L/S	0. 22 µ m L/S	0. 22 µ m L/S
10	8	0. 30 μ m L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
11	18	0. 22 μ m L/S	0. 22 µ m L/S	0. 22 µ m L/S
1 2	16	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S
13	1 5	0.30 µ m L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
14	1 5	0. 22 μ m L/S	0. 22 µ m 1/S	0.22 µ m L/S
15	1 5	0.30 µm L/S	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S
1 6	1 2	0. 22 µ m L/S	0. 22 µ m L/S	0. 22 µ m L/S
1 7	1 8	0, 22 µm L/S	0. 22 µm L/S	0.22 µ m L/S
18	10	0.30μm L/S	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S
19	2 0	0.30 µm L/S	0.30 μm L/S	0.30 µ m L/S
20	1 2	0: 25 µm L/S	0.25 µm L/S	0. 25 µ m L/S
2 1	1 6	0.30 µ m 1/S	0.30 µ m L/S	0.30μm L/S
2 2	1 2	0. 22 μ m L/S	0. 22 μm L/S	0.22 µ m L/S
2 3	15	0.30 µm L/S	0.30 m L/S	0.30 μm L/S
2 4	1 2	0. 22 μm L/S	0.22 µ m L/S	0. 22 µ m L/S
2 5	1 0	0. 25 μm L/S	0.25 µ m L/3	0.25 µ m L/S
2 6	1 5	0. 25 µ m L/S	0.25 µ m L/S	0.25 µ m L/S
2 7	18	0. 25 µ m L/S	0.25 µ m L/S	0.25 µ m L√S
2 8	1 8	0. 25 µ m L/S	0.25 µ m L/S	0.25 µ m L/S
2 9	8	0.30 µm L/S	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S
3 0	1.8	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S	0.30 µ m L/S

【0129】表5から明らかな如く実施例 $3\sim30$ の何れの実施例に於いても実施例2と同様、ポジ型パターンを形成し、実施例2と同様に露光から加熱処理(ポストベーク)迄に8時間経過しても $0.22\sim0.3~\mu$ mラインアンドスペースが全く問題なく解像された。

【0130】比較例1~9

比較の為、表6の各組成から成るフォトレジスト材料を 夫々調製し、夫々実施例2と同様にしてパターン形成を 50 行った。結果を表7に示す。又、比較例1の露光後30分経過して加熱処理(ポストベーク)、現像した場合のパターン結果(膜張り現象:T-shape)を図3に、比較例2及び3の露光後30分経過して加熱処理、現像した場合と比較例4~6及び比較例9の露光後15分経過して加熱処理、現像した場合のパターン結果(パターン形成不可)を図4に夫々示す。

【0131】尚、比較例7及び8については、露光後、

加熱処理次いで現像したところ、露光部は勿論、未露光 *【0132】 部も溶解し、パターンは全く形成できなかった。 * 【表6】 表 6

比较	ポリ(p-テトラヒドロピラニルオキシスチレン―p-ヒドロキシスチレン) (参考例1の豆合体)	5.0g
5 7]	2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例 4 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3g
	シエテレンクリコールシメテルエーテル 	13.7 g
比較例2	ボリ(p-tert-ブトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) (参考例 2 の頭合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例 4 の酸発生剤) ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.3g
比较例3	ボリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (参考例3の質合体) 2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参考例4の酸発生剤)	6. D.g 0. 3 g
	ジェチレングリコールジメチルエーテル	13.7 g
比较例 4	ボリ(p-テトラヒドロピラニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (参考例4の丘合体) ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 0.3g 13.7g
比饺例 5	ポリ (p-tert-ブトキシスチレン—p-ヒドロキシスチレン) (参考例2の面合体) ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
比较例 6	ポリ (p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (参考例3の愛合体) ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
比较例7	ボリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例1の型合体) ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
比較例8	ボリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例1の至合体) トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0 g 0.3 g 13.7 g
比较例9	ポリ {p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシスチレン] (製造例1の亞合体) トリス (トリクロロメチル) -s-トリアジン トリエタノールアミン ジエチレングリコールジメチルエーテル	6.0g 1.1g 0.1g 12.8g

比较例	露光回 (mJ/cm²)	露光から加熱処理迄の時間と解像性能				
	(ш)/ Сш /	即時	15分	30分	1時間	
1	3 0	0.35 µ m L/S	0.35 µ m L/S	膜張り	パターン形成不可	
2	3 0	0.35 μ m L/S	0.35 μ m L/S	パターン形成不可		
3	3 5	0.35 µ m L/S	0.35 µ m L/S	パターン形成不可		
4	3	0.35 μ m L/S	パターン形成不可			
5	3	0. 35 μm L/S	バターン形成不可			
6	3	0.35 μ m L/S	パターン形成不可			
7	3	パターン形成不可				
8	3	パターン形成不可				
9	6	0.40 μm L/S	パターン形成不可			

【0134】表7、図3及び図4から明らかな如くこれ 等比較例に於いては、本発明の材料を用いたレジスト材料に比較して何れも解像性能が劣る。又、比較例1~6で明らかな如く露光から加熱処理(ポストベーク)迄、15分~30分以上要すると膜張り現象(T-shape)が起こったり、パターン形成が不可能となる。又、本発明に係る重合体と、酸発生剤として既存のヨードニウム塩を 組み合わせてレジスト材料とした場合は、比較例7及び8の結果から明らかな様に露光後現像すると全て溶解し、ポジ型パターンは形成されなかった。更に、本発明に係る重合体と、酸発生剤として既存のトリス(トリクロロメチル)ーs-トリアジン/水素供与剤を組み合せてレジスト材料とした場合には、比較例9の結果より明らかな様に露光から加熱処理迄、15~30分要するとパターン形成不可能となる。

[0135]

【発明の効果】以上述べた事から明らかな如く、本発明のレジスト材料を300 nm以下の光源、例えば遠紫外光(Deep UV)、例えばKrFエキシマレーザ光(248.4 nm)等の露光用レジスト材料として用いた場合には、極 40めて高い解像性能を有し、且つ露光から加熱処理(ポストベーク)迄の時間経過に対して安定したパターン寸法の維持が可能な、実用的なクォーターミクロンオーダーの形状の良い微細なパターンが容易に得られる。従って本発明は、半導体産業等に於ける超微細パターンの形成

にとって大きな価値を有するものである。 \$ 尚、本発明のレジスト材料は遠紫外光、KrFエキシマレーザ光を利用したパターン形成に特に効果を発揮するが、 i 線光、電子線、X線等を利用したパターン形成に於いても十分使用が可能である。

48

[0136]

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例2で得られた各重合体膜の紫外線分光曲線図を示す。

【図2】図2は、本発明のレジスト材料を用いたポジ型 パターン形成方法の工程断面図である。

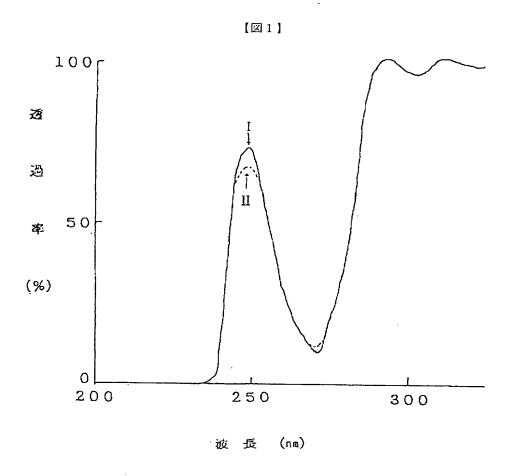
【図3】図3は、比較例1のレジスト材料を用いてポジ型パターン形成した場合に観察された膜張り現象 (T-shape)の断面図である。

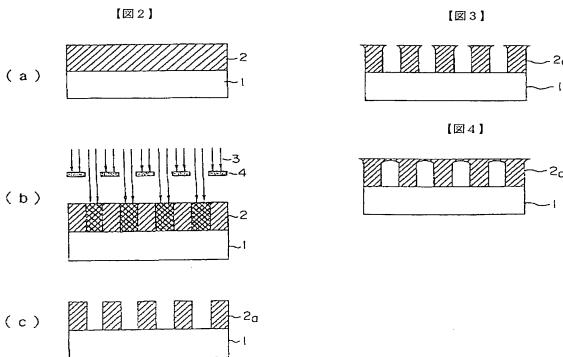
【図4】図4は、比較例2~6及び比較例9のレジスト 材料を用いてポジ型パターン形成を試みた場合に観察さ れたパターン形成不可の断面図である。

【符号の説明】

【……製造例1で得た重合体を用いて得られた重合体膜の紫外線分光曲線、 Ⅱ……製造例4で得た重合体を用いて得られた重合体膜の紫外線分光曲線、1……基板、

2……本発明化合物を含有するレジスト材料膜、 3 ……KrFエキシマレーザ光、 4……マスク、 2 a ……樹脂パターン。





【手続補正書】

【提出日】平成4年7月13日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項2】 一般式[1]で示される重合体が下記一

[式中、R¹は水素原子又はメチル基を表し、R²及びR³は夫々独立して水素原子又は炭素数1~6の直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基を表し(但し、R²及びR³が共に水素原子の場合は除く。)、又、R²とR³とで炭素数2~5のメチレン鎖を形成していても良く、R⁴は炭素数1~10の直鎖状、分枝状又は環状の

アルキ ル基、炭素数 $1\sim6$ の直鎖状、分枝状又は環状のハロアルキル基、又はアラルキ ル基を表し、k と l は夫々独立して自然数を表す $\{ 但し、 0. \ 1 \le k / (k+1) \le 0. \ 9$ である。 $\}$ 。] で示される重合体である、請求項 1 に記載のレジスト材料。

【手続補正書】

【提出日】平成4年8月7日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0086

【補正方法】変更

【補正内容】

【0086】製造例8. ポリ [p-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレンーp-ヒドロキシスチレン]の合成上記製造例3の(2)と同様にして得たポリ (p-ヒドロキシスチレン)4.8 g及びn-ブチルビニルエーテル3.0 gを1,4-ジオキサンとピリジンの混合液50mlに溶解し、これに触媒量の硫酸を添加し、室温で16時間撹拌反応させた。反応後、反応液を製造例2の(3)と同様にして処理し、ポリ [p-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレンーp-ヒドロキシスチレン]4.2 gを白色粉末晶として得た。得られた重合体のp-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレン単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は「HNMR測定より4:6であった。重量平均分子量約10000(GPC法:ポリスチレン標準)。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 3 5

【補正方法】変更

【補正内容】

[0135]

【発明の効果】以上述べた事から明らかな如く、本発明のレジスト材料を300 nm以下の光源、例えば遠紫外光(Deep IIV) 例えば F エキシストーザン (248 4

(Deep UV)、例えばKrFエキシマレーザ光 (248.4 nm)等の露光用レジスト材料として用いた場合には、極めて高い解像性能を有し、且つ露光から加熱処理 (ポストベーク) 迄の時間経過に対して安定したパターン寸法の維持が可能な、実用的なクォーターミクロンオーダーの形状の良い微細なパターンが容易に得られる。従って本発明は、半導体産業等に於ける超微細パターンの形成にとって大きな価値を有するものである。尚、本発明のレジスト材料は遠紫外光、KrFエキシマレーザ光を利用したパターン形成に特に効果を発揮するが、i線光、電子線、X線等を利用したパターン形成に於いても十分使用が可能である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

(72) 発明者 根岸 孝明 埼玉県川越市大字的場1633 和光純薬工業 株式会社東京研究所内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成7年(1995)12月8日

【公開番号】特開平5-249682

【公開日】平成5年(1993)9月28日

【年通号数】公開特許公報5-2497

【出願番号】特願平4-173830

【国際特許分類第6版】

G03F 7/039 501 7124-2H 7/004 503 7124-2H 7/028 9019-2H 7/26 7124-2H H01L 21/027

[FI]

H01L 21/30 502 R 7352-4M

【手続補正書】

【提出日】平成6年6月30日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【0003】例えば、KrFエキシマレーザ光や遠紫外 光を光源とするレジスト材料として248.4 n m付近 の光に対する透過性が高い樹脂と分子内にジアゾジケト 基を有する感光性化合物より成る溶解阻害型のレジスト 材料が開発されている(例えば、特開平1-80944 号公報;特開平1-154048号公報;特開平1-1 55338号公報;特開平1-155339号公報;特 開平1-188852号公報; Y. Taniら、SPI E's 1989 Sympo., 1086-03等)。しかし、これ等の溶解阻害型レジスト材料は共通 して感度が低く、高感度レジスト材料が要求される遠紫 外光、KFFエキシマレーザ光用途には使用出来ない。 又、近年、露光エネルギー量を低減させる方法(高感度 化)として露光により発生した酸を媒体とする化学増幅 型のレジスト材料が提案され [H. Itoら、Poly m Eng. Sci., 23巻, 1012頁 (1983 年)]、これに関して種々の報告がなされている · えば、H. I toら、米国特許 第4491628号 (1985); J. V. Crivello、米国特許 第4603101号 (1986); W. R. Bruns volt6, SPIE's 1989 Sympo... 1086-40; T. Neenanb, SPIE's 1989 Sympo., 1086-01;特開昭62 -115440号公報<u>特公平2-276</u>60号公報 等)。しかしながら、これ等既存の化学増幅型レジスト 材料は、使用される樹脂が、例えば、ポリ (4-ter

tーブトキシカルボニルオキシスチレン)、ポリ(4ーtertーブトキシカルボニルオキシーαーメチルスチレン)、ポリ(4ーtertーブトキシスチレン)、ポリ(4ーtertーブトキシーαーメチルスチレン)、ポリ(pーエテニルフェノキシ酢酸 tertーブチル等のフェノールエーテル系樹脂の場合にはいずれも耐熱性に乏しく、又、基板との密着性が不良の為現像時に膜はがれし易く、良好なパターン形状が得られないという欠点を有しており、又、カルボン酸エステル系の樹脂、例えば、ポリ(tertーブチルー4ービニルベンゾエイト)等の場合には芳香環に起因して248.4nm付近の光透過性が不十分であったり、ポリ(tertーブチルメタクリレート)等の場合には樹脂の耐熱性及びドライエッチ耐性が乏しい等の問題点を夫々有している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】尚、上記各重合体又は共重合体に於て、水酸基の保護基として使用されている、tertープトキシカルボニル基、tertープチル基、トリメチルシリル基、テトラヒドロピラニル基、tertープトキシカルボニルメトキシ基等は共通して強い酸の存在下でも完全には脱離されない為、これ等の保護基で水酸基を保護されたモノマー成分を有する重合体又は共重合体を樹脂成分として用いた既存のレジスト材料は何れも露光部と大露光部間のアルカリ現像液に対する溶解速度差が小さく、その結果、解像性能が不十分である等の問題を共通して抱えている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 1 9 【補正方法】変更 【補正内容】

【0119】(2)上記(1)で得たベンゼンスルホニ ル酢酸シクロヘキシル10g(35ミリモル)を塩化メ チレン100mlに溶解し、トリエチルアミン4.2g (41ミリモル)を添加した後30分間攪拌反応させ た。次いで参考例7の(1)で得たp-トルエンスルホ ニルアジド8.3g (39ミリモル) を0~5℃で滴下 し、同温度で4時間攪拌反応させた。反応液を濃縮し、 残渣にエチルエーテル250mlを注入、溶解し、有機 層を5%水酸化カリウム水溶液(200ml)で1回、 飽和食塩水 (100ml) で1回洗浄後、無水酢酸マグ ネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別し、溶剤を留去して 得た残渣11gをカラムクロマトグラフィ [充填剤:ワ コーゲルC-200、溶離液:n-ヘキサン/塩化メチ $\nu \nu = 6/1 \rightarrow 4/1 \rightarrow 2/1 \rightarrow 1/1$] により分離し て2-ジアゾー2-ベンゼンスルホニル酢酸シクロヘキ シル5.6gを微黄色結晶として得た。mp.42.0 ~45.0℃。

¹ HNMR δppm $(CDCl_3):1.11\sim$ 1. 82 (10H, m, シクロヘキサン環CH2)、 4. 02~4. 90 (1H, m, シクロヘキサン環C H)、7.47~8.07(5H, m, 芳香環)。 IR (Neat) $\nu \text{ cm}^{-1}$: 2160 (CN₂), 1 730 (C=0), 1365 (SO₂), 1310. <u>参考例16.ポリ(p-エテニルフェノキシ酢酸1-メ</u> <u>チルシクロヘキシル/p-ヒドロキシスチレン</u>) の合成 <u>(1) 1ーメチルシクロヘキサン-1-オール70.8</u> g(0.62モル)とピリジン8.5gを塩化メチレン 300mlに溶解し、攪拌下、クロルアセチルクロライ <u>ド70g(0.62モル)を20~30℃で滴下し、次</u> いで同温度で2時間攪拌反応させた。反応後、析出物を <u>濾去し、溶媒留去して得られた残渣116gをカラムク</u> <u>ロマトグラフィ精製「充填剤:ワコーゲルC-200、</u> <u>溶離液: n - ヘキサン/酢酸エチル=10/1 (V/</u> <u>V)] してモノクロル酢酸 1 - メチルシクロヘキシル 5</u> 3.2gを微黄色油状物として得た。

18 (13H, s, CH₃及びシクロヘキサン環CH), 4.00 (2H, s, CH₂)。
IR (Neat) vcm⁻¹:1760 (C=0)。
(2) 製造例3の(2) で得たポリ (pーヒドロキシスチレン) 4.0 gと上記(1) で得たモノクロル酢酸1ーメチルシクロヘキシル3.2 gをアセトン35mlに溶解させ、これに炭酸カリウム2.4 g及びヨウ化カリ

 $^{-1}$ HNMR δ ppm (CDCl₃):1.27~2.

ウム 0. 33 gを添加して攪拌下、6時間還流反応を行った。 冷却後、析出物を濾去し、濾液を水 6 0 0 m l 中に注入、晶析させ、析出晶を濾取、水洗、乾燥してポリ (p-エテニルフェノキシ酢酸1-メチルシクロヘキシル/p-ヒドロキシスチレン) 4. 9 gを白色粉末晶として得た。 得られた重合体のp-エテニルフェノキシ酢酸1-メチルシクロヘキシル単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は一HNMR測定より約1:1であった。又、重量平均分子量は約10,000 (GPC法:ポリスチレン標準)であった。

参考例17. ポリ (p-エテニルフェノキシ酢酸 tertーブチル/p-ヒドロキシスチレン) の合成製造例3の(2)で得たポリ (p-ヒドロキシスチレン) 4. 0gとモノクロル酢酸 tertーブチル (市販品) 2. 6gとを用いて参考例16の(2)と同様に反応及び後処理を行い、ポリ (p-エテニルフェノキシ酢酸 tertーブチル/p-ヒドロキシスチレン) 5. 0gを自色粉末晶として得た。得られた重合体のp-エテニルフェノキシ酢酸 tertーブチル/p-ヒドロキシスチレン) 5. 0gを自色粉末晶として得た。得られた重合体のp-エテニルフェノキシ酢酸 tertーブチル単位とp-ヒドロキシスチレン単位の構成比は一HNMR測定より約1:1であった。又、重量平均分子量は約10,000(GPC法:ポリスチレン標準)であった。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 3 0

【補正方法】変更

【補正内容】

【0130】比較例1~<u>11</u>

比較の為、表6の各組成から成るフォトレジスト材料を 夫々調製し、夫々実施例2と同様にしてパターン形成を 行った。結果を表7に示す。又、比較例1の露光後30 分経過して加熱処理(ポストベーク)、現像した場合の パターン結果(膜張り現象:T-shape)を図3 に、比較例2及び3の露光後30分経過して加熱処理、 現像した場合と比較例4~6及び比較例9の露光後15 分経過して加熱処理、現像した場合のパターン結果(パターン形成不可)を図4に夫々示す。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 3 2

【補正方法】変更

【補正内容】

[0132]

【表 6 】

比奴	ポリ(p・テトラヒドロピラニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (您特得 1 の弦合体)	6.0g
9月	2- (シクロヘキシルカルポニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (参写例4の段発生剤)	0.3g
_	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7g
比吸	ポリ(p-tert-ブトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) (毎年例2の瓦合体)	6.0g
6 4	2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (p-トルエンスルホニル) プロパン (歩名例 4 の政発生剤)	0.3g
Ľ	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7g
比较	ポリ(p-tert-プトキシカルボニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (包容例3の登合体)	5. 0 g
E 3	2- (シクロヘキシルカルボニル) -2- (テトルエンスルホニル) プロパン (恋勾例4の散発生剤)	0.3g
	ジェチレングリコールジメチルエーテル	13.7 g
比較	ポリ(p-チトラヒドロピラニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (歩弯例4 の舌合体)	5. 0 g
9 4	ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3 g 13.7 g
比较	ポリ(p-tert-ブトキシスチレンーp-ヒドロキシスチレン) (参考例2の登合体)	6.0g
6 9	ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3g 13.7g
比较	ポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン-p-ヒドロキシスチレン) (参考例3の受合体)	6. 0 g
67 6	ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート ジスチレングリコールジメチルエーテル	0.3 g 13.7 g
世	ポリ [p- (1-エトキシエトキシ) スチレンーp-ヒドロキシステレン]	
88 83	(契達例1の致合体) (ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート	6.0g 0.3g
7	ジエチレングリコールジメチルエーテル	13.7g
比较	ポリ [p- (l-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン] (製造例1 の良合体)	6.0g
8	トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3g
比	ポリ [p- (l-エトキシエトキシ) スチレン-p-ヒドロキシスチレン]	
皎	(製造例1 の弦合体) トリス(トリクロロメチル)-s・トリアジン	6.0g
9	トリエタノールアミン ジエチレングリコールジメチルエーテル	0. lg
共	ボリ(アエテニルフェノキン酢酸 レメチルシクロヘキシルー	
	p-ヒドロキシスチレン) (参考例16の式合体) 2-(シクロヘキシルカルボニル)-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン	6.0g
10	ジェチレングリコールジメチルエーテル	13.7g
五数五	ポリ (p-エテニルフェノキシ酢酸 tert-ブチルーp-ヒドロキシスチレン) (毎5例17の五合体)	6.0g
11	2-(シクロヘキシルカルボニル)-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン ジエチレングリコールジメチルエーテル	0.3g 13.7g

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 3 3

【補正方法】変更

【補正内容】

[0133]

【表7】

表7

比较例	以北四 (aJ/cm²)	為光から加急処理迄の時間と採収生能				
	(m)(cm)	助峙	15分	30分	1 時間	8時國
1	3 0	0.35 µ m L/S	0.35 µ m L/S	既張り	パターン形成不可	
2	3 0	0.35 µ m L/S	0.35 µ m L/S	パターン形成不可		
3	3 5	0.35 µm L/S	0.35 µ m L/S	パターン形成不可		
4	3	0.35 µ m L/S	パターン形成不可			
5	3	0.35 µm L/S	パターン形成不可			
6	3	0.35 µm L/S	パターン形成不可			
7	3	パターン形成不可				
8	3	パターン形成不可				
9	6	0.40 µ m L/S	パターン形成不可			
10	3 5	0.40 µ m L/S	0.40 μ m L/S	0.40 µ m L/S	0.40 µm L/S	^*9->/形成不可
11	3 8	0.40 µ m L/S	0.40 μ m L/S	パターン形成不可		

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 3 4

【補正方法】変更

【補正内容】

【0134】表7、図3及び図4から明らかな如くこれ 等比較例に於いては、本発明の材料を用いたレジスト材料に比較して何れも解像性能が劣る。又、比較例1~ 6、10及び11で明らかな如く露光から加熱処理(ポストベーク)迄、<u>殆どの場合、</u>15~30分以上<u>(一部</u>8時間以上)要すると膜張り現象(T-shape)が 起こったり、パターン形成が不可能となる。又、本発明に係る重合体と、酸発生剤として既存のヨードニウム塩やスルホニウム塩を組み合わせてレジスト材料とした場合は、比較例7及び8の結果から明らかな様に露光後現像すると全て溶解し、ポジ型パターンは形成されなかった。更に、本発明に係る重合体と、酸発生剤として既存のトリス(トリクロロメチル)-s-トリアジン/水素供与剤を組み合せてレジスト材料とした場合には、比較例9の結果より明らかな様に露光から加熱処理迄、15~30分要するとパターン形成不可能となる。